

SIEMENS

SIMATIC

産業用 PC SIMATIC IPC PX-32A

操作説明書

まえがき

製品の説明

1

安全に関する注意事項

2

装置の設置と接続

3

装置のコミッショニング

4

デバイスの操作

5

パラメータの装置への拡張
および割り当て

6

装置の保守と修理

7

技術仕様

8

寸法図

9

規格と承認

10

ハードウェアの説明

A

技術サポート

B

マークおよびシンボル

C




略語リスト

D

法律上の注意

警告事項

本書には、ユーザーの安全性を確保し製品の損傷を防止するうえ守るべき注意事項が記載されています。ユーザーの安全性に関する注意事項は、安全警告サインで強調表示されています。このサインは、物的損傷に関する注意事項には表示されません。以下に表示された注意事項は、危険度によって等級分けされています。

 危険
回避しなければ、直接的な死または重傷に至る危険状態を示します。
 警告
回避しなければ、死または重傷に至るおそれのある危険な状況を示します。
 注意
回避しなければ、軽度または中度の人身傷害を引き起こすおそれのある危険な状況を示します。
通知
回避しなければ、物的損傷を引き起こすおそれのある危険な状況を示します。


複数の危険レベルに相当する場合は、通常、最も危険度の高い事項が表示されることになっています。安全警告サイン付きの人身傷害に関する注意事項があれば、物的損傷に関する警告が付加されます。

有資格者

本書が対象とする製品 / システムは必ず有資格者が取り扱うものとし、各操作内容に関連するドキュメント、特に安全上の注意及び警告が遵守されなければなりません。有資格者とは、訓練内容及び経験に基づきながら当該製品 / システムの取り扱いに伴う危険性を認識し、発生し得る危害を事前に回避できる者をいいます。

シーメンス製品を正しくお使いいただくために

以下の事項に注意してください。

 警告
シーメンス製品は、カタログおよび付属の技術説明書の指示に従ってお使いください。他社の製品または部品との併用は、弊社の推奨もしくは許がある場合に限りです。製品を正しく安全にご使用いただくには、適切な運搬、保管、組み立て、据え付け、配線、始動、操作、保守を行ってください。ご使用になる場所は、許容された範囲を必ず守ってください。付属の技術説明書に記載されている指示を遵守してください。

商標

®マークのついた称号はすべて Siemens Aktiengesellschaft の商標です。本書に記載するその他の称号は商標であり、第三者が自己の目的において使用した場合、所有者の権利を侵害することになります。

免責事項

本書のハードウェアおよびソフトウェアに関する記述と、実際の製品内容との一致については検証済みです。しかしなお、本書の記述が実際の製品内容と異なる可能性もあり、完全な一致が保証されているわけではありません。記載内容については定期的に検証し、訂正が必要な場合は次の版で更新いたします。

まえがき

この操作説明書の目的

これらの操作説明書には、SIMATIC IPC PX-32A を設置、電気接続、コミッショニングおよび拡張し、装置を修理および保守するために必要なすべての情報が含まれます。これらは、次の有資格スペシャリスト担当者を対象としています。

- 設置担当者
- コミッショニングエンジニア
- IT 管理者
- サービスおよび保守担当者

必要な基礎知識

この取扱説明書を理解するには、電气的設置、パーソナルコンピュータ、Microsoft オペレーティングシステムおよびネットワークテクノロジーに関する十分な知識が必要です。フィールドオートメーション制御エンジニアリングの一般知識があることが推奨されます。

操作説明書の適用範囲

これらの操作説明書は、SIMATIC IPC PX-32A のすべての注文バージョンで有効です。

履歴

この操作説明書の次のエディションは、既に発行されています。

エディション	コメント
2023 年 9 月	第 1 版
2024 年 6 月	修正

サイバーセキュリティ情報

Siemens は、工場設備、システム、機械およびネットワークの安全な稼動をサポートする産業セキュリティ機能を有する製品やソリューションを提供しています。

工場設備、システム、機械およびネットワークをサイバー脅威から保護するため、総合的な、最新の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的にメンテナンスすることが必要です。Siemens の製品およびソリューションは、それらのコンセプトの 1 つの要素のみを形成します。Siemens の製品およびソリューションは、そのようなコンセプトの 1 つの要素を形成します。

お客様は、プラント、システム、機械およびネットワークへの許可されていないアクセスを防ぐ責任があります。これらのシステム、機械および構成部品は、そのような接続が必要な場合、適切なセキュリティ措置(ファイアウォールおよび/またはネットワークセグメンテーションを使用)が適所で実施されている場合にのみ、エンタープライズネットワークまたはインターネットに接続する必要があります。

産業用セキュリティ対策に関する詳細な情報は、こちら (<http://www.siemens.de/industrialsecurity>) をご覧下さい。

Siemens の製品およびソリューションは、セキュリティを向上させるための継続的な開発を経たものです。Siemens は、利用可能になったらすぐ製品の更新プログラムを適用し、常に最新の製品バージョンを使用することを強くお勧めします。もはやサポートされていない製品バージョンを使用して、最新の更新適用を怠ってしまうと、お客様のサイバー脅威への暴露を高めてしまうことがあります。

製品更新の最新情報を入手するため、Siemens の産業セキュリティの RSS フィード (こちら (<https://www.siemens.com/cert>)) を購読します。

サードパーティ製ソフトウェアの更新に関する免責事項

この製品には、サードパーティ製のソフトウェアが含まれています。Siemens Aktiengesellschaft は、サードパーティ製ソフトウェアが Siemens ソフトウェアアップデートサービス契約の一部として配布されている場合または Siemens Aktiengesellschaft によって正式にリリースされている場合のみ、サードパーティ製ソフトウェアの更新/パッチに対する保証を提供します。それ以外の場合は、更新/パッチは、ユーザーご自身の責任で適用することになります。当社のソフトウェアアップデートサービス提供に関する詳細な情報は、インターネットの Software Update Service (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109759444>) を参照してください。

目次

	まえがき	3
1	製品の説明	9
1.1	装置を操作するための重要な指示およびマニュアル	9
1.2	製品ハイライト	11
1.3	アプリケーション	13
1.4	装置の外部デザイン	14
1.4.1	インターフェースおよび操作エレメント	14
1.4.2	ステータス表示	15
1.5	装置の内部設計	16
1.6	付属品とスペア部品	17
1.6.1	ハードウェアアクセサリ	17
1.6.2	ソフトウェアの付属品	18
2	安全に関する注意事項	19
2.1	一般的な安全上の注意事項	19
2.2	輸送と保管に関する注意事項	22
2.3	取り付けに関する注意	23
2.4	周辺条件および環境条件に関する注意事項	24
2.5	I/O デバイスに関する情報	27
2.6	タッチスクリーンについての注意事項	28
2.7	装置およびシステム拡張に関する注意事項	30
3	装置の設置と接続	31
3.1	設置準備	31
3.1.1	納品範囲	31
3.1.2	納品パッケージの確認	32
3.1.3	装置のデータの識別	33
3.1.4	据え付け位置	34
3.1.5	取り付けカットアウトの準備	36
3.2	装置の設置	38
3.2.1	設置のガイドライン	38
3.2.2	取り付けクリップを使用した装置の取り付け	40
3.2.3	VESA アダプタを使用した装置の固定	43

3.3	装置の接続	45
3.3.1	保護導体の接続	45
3.3.2	電源の接続	46
3.3.2.1	端子の接続	46
3.3.2.2	9-36 V DC 電源の接続	48
3.3.3	I/O 装置の接続	50
3.3.4	ネットワークへの装置の接続	52
3.3.5	ケーブルの固定	53
4	装置のコミッショニング	54
4.1	装置の電源スイッチ投入	54
4.2	装置をオフにする	55
5	デバイスの操作	57
5.1	可能な操作	57
5.2	Trusted Platform Module (TPM)	58
6	パラメータの装置への拡張および割り当て	59
6.1	装置を開く	59
6.2	拡張モジュール(M.2)	61
6.2.1	使用可能な拡張モジュール(M.2)	61
6.2.2	拡張モジュールの取り付け/取り外し(M.2)	62
6.3	メモリモジュール	65
6.3.1	メモリモジュールの取り付けおよび取り外し	65
6.4	ドライブ	67
6.4.1	M.2 NVMe SSD の交換	67
7	装置の保守と修理	69
7.1	修理に関する情報	69
7.2	保守間隔	69
7.3	装置前面のクリーニング	70
7.4	ハードウェアの取り外しと設置	71
7.4.1	バックアップバッテリーの交換	71
7.5	オペレーティングシステム、ソフトウェアおよびドライバのインストール	74
7.6	ファームウェア/BIOS の設定	75
7.7	データバックアップおよびパーティション変更	75
7.8	リサイクルと廃棄処分	75

8	技術仕様	76
8.1	技術仕様の適用可能性	76
8.2	一般的な技術仕様	76
8.3	電流/電力要件および電源	78
8.3.1	システムコンポーネントの電流および電力要件	78
8.3.2	技術仕様: DC 電源(DC)	79
8.4	Electromagnetic compatibility (電磁環境両立性).....	80
8.5	周辺環境.....	81
8.6	ドライブの技術仕様.....	82
8.7	マザーボードの技術仕様	82
8.8	グラフィック/ディスプレイの技術仕様	83
8.9	インターフェースの技術仕様	84
8.10	オペレーティングシステムの技術仕様	85
9	寸法図	86
9.1	抵抗性シングルタッチスクリーン搭載 12"装置の寸法図	86
9.2	抵抗性シングルタッチスクリーン搭載 15"装置の寸法図	87
9.3	抵抗性シングルタッチスクリーン搭載 19"装置の寸法図	88
9.4	抵抗性シングルタッチスクリーン搭載 22"装置の寸法図	89
9.5	拡張モジュールの寸法図(M.2)	90
10	規格と承認	91
10.1	適用範囲.....	91
10.2	CE マーキング	91
10.3	UKCA マーキング	92
10.4	DIN ISO9001 認証とソフトウェアライセンス契約.....	92
10.5	UL 認可	92
10.6	FCC (USA)	93
10.7	カナダ.....	94
10.8	オーストラリア/ニュージーランド	94
10.9	ユーラシア関税同盟 EAC	94
10.10	韓国	94
10.11	台湾	95

A	ハードウェアの説明	97
A.1	マザーボード	97
A.1.1	マザーボードのレイアウト	97
A.1.2	マザーボードのインターフェース位置	98
A.2	内部インターフェース	99
A.2.1	内部インターフェースのピン割り付け	99
A.2.2	USB ポート	99
A.3	外部インターフェース	100
A.4	システムリソース	101
A.4.1	現在割り当てられているシステムリソース	101
A.4.2	I/O アドレス割り付け	101
A.4.2.1	内部モジュールレジスタの概要	101
A.4.2.2	バッテリステータスレジスタ(書き込み禁止)	102
A.4.2.3	ウォッチドッグタイマー(WDT)レジスタ(読み取り/書き込み)	103
A.4.2.4	NVRAM アドレスレジスタ	106
B	技術サポート	107
B.1	サービスおよびサポート	107
B.2	トラブルシューティング	108
B.2.1	装置の機能の問題	108
B.2.2	装置を起動するときの問題	110
C	マークおよびシンボル	111
C.1	概要	111
C.2	安全性	111
C.3	オペレータ制御	111
C.4	認証、承認およびマーク	112
C.5	インターフェース	113
D	略語リスト	114
D.1	略語	114
	索引	117

製品の説明

1.1 装置を操作するための重要な指示およびマニュアル

取扱説明書	目次	ソース
操作説明書	<ul style="list-style-type: none"> 製品の説明 技術仕様 装置の設置 装置の操作 ハードウェアの設置と取り外し 寸法図 	<ul style="list-style-type: none"> オンライン: SIMATIC IPC マニュアル (http://www.siemens.com/simatic-ipc-doku-portal)
クイックインストールガイド	情報内容: <ul style="list-style-type: none"> 装置の操作説明書 装置の設置 装置を電源に接続する手順 I/O 装置の接続 装置の電源スイッチ投入 	<ul style="list-style-type: none"> 印刷された形式で装置に同梱
製品の最新情報	<ul style="list-style-type: none"> 装置に関する最新の注意事項 これらの操作説明書と比較した変更点 	<ul style="list-style-type: none"> オンライン: SIMATIC IPC マニュアル (http://www.siemens.com/simatic-ipc-doku-portal)
ファームウェア / BIOS の説明	情報内容: <ul style="list-style-type: none"> 重要なファームウェア設定 工場出荷時設定でのファームウェア設定 ブートモード 	<ul style="list-style-type: none"> オンライン:ファームウェア / BIOS の説明 SIMATIC IPC BX-39A、IPC PX-39A、IPC PX-39A PRO (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109811365)

1.1 装置を操作するための重要な指示およびマニュアル

取扱説明書	目次	ソース
Windows®オペレーティングシステム	<p>情報内容:</p> <ul style="list-style-type: none"> • オペレーティングシステムのコミッショニング • オペレーティングシステムの復元 • オペレーティングシステムの設定 	<ul style="list-style-type: none"> • オンライン: Microsoft® Windows® 10 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109749498)
SIMATIC IPC Image & Partition Creator	<p>情報内容:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ファイル、ディレクトリ、ドライブパーティションのバックアップおよび復元 	<ul style="list-style-type: none"> • オンライン: SIMATIC IPC Image & Partition Creator (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109803590)
SIMATIC NET	工業用通信	<ul style="list-style-type: none"> • オンライン: SIMATIC NET (http://w3.siemens.com/mc_ms/automation/en/industrial-communications/Pages/Default.aspx)
SIMATIC IPC によるブート可能な USB フラッシュドライブの作成	<p>情報内容:</p> <ul style="list-style-type: none"> • オペレーティングシステム、ソフトウェア、ドライブのリカバリのためにブート可能な USB フラッシュドライブを作成 	<ul style="list-style-type: none"> • オンライン: SIMATIC IPC によるブート可能な USB フラッシュドライブの作成 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109811224)

1.2 製品ハイライト

革新的な Intel プロセッサアーキテクチャを搭載した SIMATIC IPC PX-32A は、埋め込みシリーズを補完する、コスト最適化された工業用パネル PC です。これは、SIMATIC IPC PX-39A の価格と機能を抑えた機種です。

デバイス図



注記

注文した設定に応じて、このマニュアルで説明されている機能および図がお使いの装置の機能と異なることがあります。

高速データ処理による高生産性

- 第 11 世代 Intel Xeon プロセッサを使用する埋め込みセグメントでの高性能
- 4 つの異なるプロセッサを使用する拡張性 - Intel Celeron から Intel Xeon
- 最大 32 GB までの DDR4 を使用する最新のメモリ技術

1.2 製品ハイライト

機械で使用するために設置するときの柔軟性

- スペースを最適化した設置のための最小取り付け深度
- 柔軟な取り付けオプション(縦置き、横置き)
- 最高 50 °C の周囲温度での使用に対応する堅牢な筐体コンセプト

埋め込みソリューションの実装のための工業用機能性および柔軟性

- 2 x LAN 10/100/1000 Mbps 接続、チーミング互換性
- 4 x 高速 USB 3.2 ポート、最大 4 つのシリアルインターフェース
- 簡単に拡張可能(1 x M.2 モジュール)
- オン/オフスイッチ

停止時間を最短化することによる高システム可用性

- 回転部品(ファン、ハードドライブ)がないためメンテナンスフリーで電池を使用しない運転が可能
- 最大 1 つの M.2 NVMe SSD (最新の冷却ソリューションを使用して内部取り付け)
- SIMATIC ソフトウェア

エンジニアリングコストの低減による高い投資安全性

- 長期的な可用性:市場投入から 8 ~ 10 年間提供される整備およびサポート

装置バージョン

抵抗性シングルタッチスクリーン付き装置

- 12"ディスプレイ、解像度:1280 x 800 ピクセル
- 15"ディスプレイ、解像度 1366 x 768 ピクセル
- 19"ディスプレイ、解像度:1366 x 768 ピクセル
- 22"ディスプレイ、解像度:1920 x 1080 ピクセル

1.3 アプリケーション

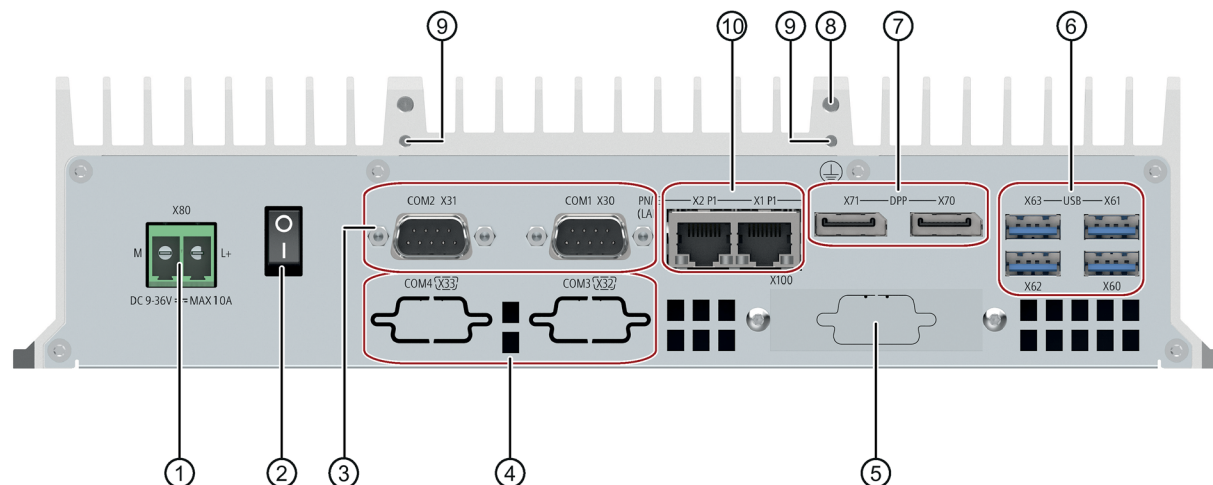
この装置は、特に機械、プラントおよび制御キャビネットエンジニアリング製造業者に、高パフォーマンスで省スペースの産業用 PC システムを提供します。

- プロセスおよびモニタアプリケーション
- 工業用画像処理
- 品質保証およびモニタタスク
- 測定、制御およびルールベースのタスク
- データ取得および管理

1.4 装置の外部デザイン

1.4.1 インターフェースおよび操作エレメント

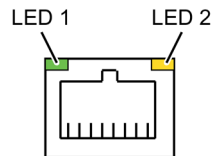
インターフェースとオペレータ制御の表示



- | | | |
|---|----------------------------------|---|
| ① | 9-36 V DC
X80 | 電源接続 |
| ② | オン/オフスイッチ | オン/オフスイッチで装置をオンにします。オン/オフスイッチでは、装置は電源から切り離されません。
<ul style="list-style-type: none"> • 「_」記号が押されると、「オン」位置になります。 • 「o」位置は納入状態です。 |
| ③ | COM1 X30 および
COM2 X31 | シリアルインターフェース 1 および 2 (V.24)、9 ピン D-sub ソケット、RS485/RS232 |
| ④ | COM3 X32 および
COM4 X33 (オプション) | シリアルインターフェース 3 および 4 (V.24)、9 ピン D-sub ソケット、RS232 (オプション) |
| ⑤ | 拡張インターフェース
X100 用開口部 | 外部拡張モジュールのインターフェース(M.2 フォーマット) |
| ⑥ | 4 × USB
X60/X61/X62/X63 | USB 3.2 Gen 2 タイプ A、高電流、下位互換性あり |
| ⑦ | 2 × DPP
X70/X71 | DisplayPort インターフェース付きモニター用接続部 |
| ⑧ | 保護導体 | 保護設置用接続 |
| ⑨ | ストレーンリリーフの
固定ネジ用位置 | |
| ⑩ | 2 × Ethernet
X1 P1/X2 P1 | 10/100/1000 Mbps 対応 Ethernet RJ45 用接続部
<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet X1 P1 は iAMT 互換です • Ethernet X2 P1 |

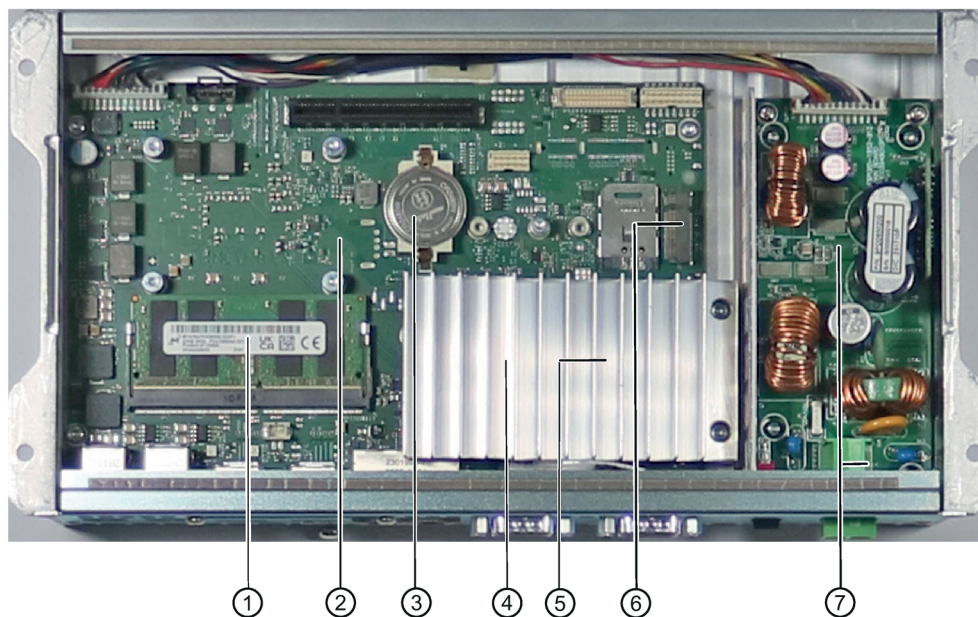
1.4.2 ステータス表示

ステータスインジケータの Ethernet インターフェース X1 P1 および X2 P1



ステータス表示	状態	ステータスの意味
LED 1	消灯	10 Mbps
	緑色に点灯	100 Mbps
	オレンジ色に点灯	1000 Mbps
LED 2	消灯	接続なし
	オレンジ色に点灯	接続が存在
	オレンジ色に点滅	動作中

1.5 装置の内部設計



- ① メモリモジュール用スロット
- ② マザーボード
- ③ バックアップバッテリー
- ④ ドライブ(SSD)用ヒートシンク
- ⑤ ヒートシンクでのドライブ(SSD)用スロット
- ⑥ M.2 拡張モジュール用のスロット
- ⑦ 電源 9-36 V DC

1.6 付属品とスペア部品

1.6.1 ハードウェアアクセサリ

納品範囲に含まれていない Siemens からの付属品は、お使いの装置用に入手可能です。

SIEMENS Industry Mall からの付属品の入手

1. インターネットで、Industry Mall (<https://mall.industry.siemens.com>)に進みます。
2. お客様のデータを使用してログインします。
3. ユーザー言語を選択します。
4. 製品カタログでお使いの装置を開きます(左側のツリー構造):
[オートメーション技術] > [PC ベースのオートメーション] > [産業用 PC] > [パネル PC] > [...]
5. 左側のツリー構造で、次をクリックします:SIMATIC IPC PX-32A
6. 表示領域で[付属品]タブを選択します。

SIEMENS スペア部品サービス

スペア部品の注文、提供および納入に関する情報は、「産業的オンラインサポート：スペア部品サービス (<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/16611927>)」で参照できます。

1.6 付属品とスペア部品

1.6.2 ソフトウェアの付属品

特に次のソフトウェア製品は、お使いの装置向けに追加で注文することができます。

ソフトウェア	説明
SIMATIC IPC Image & Partition Creator	SIMATIC IPC Image & Partition Creator は、個別データとファイル、ハードディスク全体および他のデータストレージ媒体の簡単なバックアップやクイックリカバリを可能にします。 直感的なユーザーインターフェースは、ディスクおよびパーティション管理機能を提供します。
SIMATIC IPC DiagMonitor	SIMATIC IPC DiagMonitor は、ローカルモニタ機能に加え、リモートでの IPC のモニタリング、他のシステムとの通信、世界中でのアラーム通知および特許を取得したモニタリングアプリケーションの作成を行うオプションも提供しています。

ソフトウェア製品に関する詳細情報およびオンラインカタログおよび注文システム (Industry Mall (<https://mall.industry.siemens.com>))への参照情報は、SIMATIC IPC ソフトウェア (http://www.automation.siemens.com/mcms/pc-based-automation/en/industrial-pc/expansion_components_accessories)ホームページを参照できます。

安全に関する注意事項

2.1 一般的な安全上の注意事項



警告

システムの設置者は、装置が統合されているシステムの安全性に責任があります。
死亡事故や重傷を引き起こす可能性がある誤動作の危険があります。

- 適切な有資格の担当者のみが作業を実行するようにしてください。

電気ショックによるリスク



警告

感電のリスク


オン/オフボタンおよびオン/オフスイッチでは、装置は電源から完全に切り離されません。

装置または接続線に損傷がある場合、火災が発生するリスクもあります。


- 装置に対して作業を実施する前、または装置を長期間使用しないときは、装置を必ず電源から完全に切り離してください。
- 制御キャビネットの取り付け:可能な場合、装置の近くで、集中化された、簡単にアクセス可能な AC 回路ブレーカーを使用します。
- 装置を設置するとき、電源コネクタに簡単にアクセスできるようにします。

2.1 一般的な安全上の注意事項

落雷の危険

 危険
<p>落雷の危険</p> <p>落雷がメインケーブルおよびデータ伝送ケーブルに入り、人が感電する場合があります。</p> <p>死亡、重傷および火傷の原因になる可能性があります。</p> <ul style="list-style-type: none">• 雷雨が近づいているとき、早めに装置を主電源から切り離してください。• 雷が鳴っている間は、電源ケーブルおよびデータ伝送ケーブルに触らないでください。• 電気ケーブル、配電器、システムなどから十分な距離を保ってください。

火傷の危険

 注意
<p>火傷の危険</p> <p>装置の表面は、65°C を超える温度に達する可能性があります。</p> <ul style="list-style-type: none">• 保護されていない接点は、火傷の原因になる場合があります。• 装置の動作中は、直接触らないでください。• 装置に触れる場合は、必ず適切な保護手袋を使用してください。

機能制限の回避

通知
<p>未確認プラント運営の場合に起こりうる機能制限</p> <p>本装置は、技術標準に基づいて試験され認証されています。まれに、プラント運営中に機能制限が発生することがあります。</p> <p>機能制限を回避するには、プラントの正常な動作を検証する必要があります。</p>

TFT ディスプレイ

注記

バーンイン効果およびバックライティング

バックライトを明るくすると、スクリーンの耐用年数が短くなります。明るい画面オブジェクトによる画像を常時使用すると、バーンイン効果の原因になります。

- スクリーンセ이버を使用して、スクリーンとバックライトの寿命を延ばし、バーンイン効果を回避します。

注記

ディスプレイの不完全ピクセル

現行のディスプレイの製造工程では、ディスプレイのすべてのピクセルが完全であることは現時点では保証されません。このため、ディスプレイにおける若干の不完全なピクセルは避けられません。不完全なピクセルすべてが1つの場所に集中しない限り、これが機能を何らかの仕方で制限してしまうことはありません。

工業環境での使用

注記

追加の保護対策を使用しない工業環境での使用

この装置は、IEC 60721-3-3 に従って、通常の工業環境で使用するために設計されました。

ESD 指令

静電気に敏感な装置には、適切なシンボルでラベル付けすることができます。



通知

静電放電により破損する恐れのある部品(ESD)

装置には、静電気によって破損する可能性のある電子部品が内蔵されています。これは、機械やプラントの故障や損傷が生じるおそれがあります。

装置を開く前に、対応する予防措置を講じる必要があります。

2.2 輸送と保管に関する注意事項

輸送と保管に起因する損傷

通知

輸送および保管時の装置の損傷

装置が梱包されずに輸送または保管された場合、衝撃、振動、圧力、および湿気が、保護されていないユニットに影響を及ぼした可能性があります。損傷した梱包は、周囲条件によって装置がすでに大きな影響を受けており、装置が損傷している可能性があることを示しています。

これにより、装置、機械、またはプラントが機能不良になることがあります。

- 元の梱包を保持してください。
- 装置は、輸送および保管するために、元の梱包材で梱包してください。

警告

破損した装置が原因の電氣的衝撃および火災の危険

破損した装置は、危険な電圧にさらされ、機械またはプラントで火災を引き起こす可能性があります。破損した装置は、予測できない特性を持ち、予測できない状態になっています。

死亡または重傷の恐れがあります。

- 損傷した装置の設置およびコミッショニングはしないでください。
- 損傷した装置にラベルを付け、しっかり保管してください。速やかな修理のために装置をお送りください。

結露による損傷

通知

結露による損傷

装置が輸送中に低温または極端な温度変動にさらされる場合、HMI デバイス表面または内部に湿気が発生することがあります(結露)。

湿気は電気回路の短絡の原因となり、装置を損傷することがあります。

- 装置は乾燥した場所に保管してください。
- 装置は、起動する前に室温に合わせてください。
- 装置を過熱装置からの直接の熱放射に曝さないでください。
- 結露が発生した場合、12 時間程度待つか、装置が完全に乾いてからオンにします。

2.3 取り付けに関する注意

制御キャビネット内の装置

危険

制御キャビネットが開いている場合の感電死のリスク

制御キャビネットを開くとき、一部の領域またはコンポーネントは、恐らく他の装置が原因で、感電死に至る電圧が印加されている場合があります。

こうした領域やコンポーネントに触れると、死亡や重傷を引き起こす危険がありません。

- パネルを開く前に常にキャビネットと主電源を切断してください。
- 制御キャビネットの電源が偶発的にオンにならないように注意してください。

2.4 周辺条件および環境条件に関する注意事項

周辺環境および環境条件

通知

周辺条件および耐化学性

不適切な周辺条件は、装置を故障させたり、損傷させる可能性があります。準拠を怠ると、IEC/UL/EN/DIN-EN 61010-2-201 に従った保証が無効になります。

- 装置は閉め切った室内でのみ操作してください。
- 技術仕様で指定された周辺条件に従って装置を操作してください。
- 装置の設置時には、許容設置位置に準拠します。
- 装置の通気口はカバーしないでください。
- 腐食性の蒸気や気体により周辺条件が極端に厳しい場所で装置を操作する場合は、必ず新鮮な空気を供給するようにしてください。
- 濡れた布を使って筐体表面を清掃し、装置に水が入り込まないようにしてください。

アプリケーションの計画時には、次の点を考慮してください。

- 操作説明書で指定されている気候および機械的な使用環境条件を考慮してください。
- 装置を腐食性の蒸気や気体にさらされる過酷な環境では操作しないでください。
- キャビネットの取り付けについては、SIMATIC 設計ガイドライン、関連する DIN/VDE 要件または当該国固有の規則に留意してください。
- 通気口スロットの領域に最低 50 mm の空間を常に確保し、筐体の通気スロットを覆わないでください。

6 コアおよび 8 コアプロセッサ(Intel Xeon W-11555MLE 搭載の 6AV7272-5....-....および Intel Xeon W-11865MLE 搭載の 6AV7272-7....-....)を搭載した装置の周辺条件および環境条件

通知

周辺条件および耐化学性

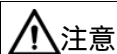
不適切な周辺条件は、装置を故障させたり、損傷させる可能性があります。準拠を怠ると、IEC/EN/DIN-EN 61010-2-201 に従った保証が無効になります。

- 装置は閉め切った室内でのみ操作してください。
- 技術仕様で指定された周辺条件に従って装置を操作してください。
- 装置の設置時には、許容設置位置に準拠します。
- 装置の通気口はカバーしないでください。
- 腐食性の蒸気や気体により周辺条件が極端に厳しい場所で装置を操作する場合は、必ず新鮮な空気を供給するようにしてください。
- 濡れた布を使って筐体表面を清掃し、装置に水が入り込まないようにしてください。

アプリケーションの計画時には、次の点を考慮してください。

- 操作説明書で指定されている気候および機械的な使用環境条件を考慮してください。
- 装置を腐食性の蒸気や気体にさらされる過酷な環境では操作しないでください。
- キャビネットの取り付けについては、SIMATIC 設計ガイドライン、関連する DIN/VDE 要件または当該国固有の規則に留意してください。
- 通気スロットの領域に最低 100 mm の空間を常に確保し、筐体の通気スロットを覆わないでください。

高周波放射



無線外乱に対する耐性

本デバイスは、技術仕様の電磁環境適合性に関する仕様に従って、無線放射への耐性が向上しています。

指定されたイミュニティ範囲外の高周波放射は、装置の故障を引き起こすことがあります。

負傷したり、プラントが損傷したりします。

- 高周波放射を回避します。
- 装置の環境から放射源を取り除きます。
- 放射している装置をオフにします。
- 放射している装置の出力を減少させます。
- 電磁環境適合性に関する情報をお読みください。
- 技術仕様の情報をお読みください。

下記も参照

周辺環境 (ページ 81)

2.5 I/O デバイスに関する情報

注意

I/O 装置が原因の故障

I/O 装置を接続すると、装置の故障の原因になる可能性があります。

負傷および機械やプラントの損傷につながる場合があります。

- EN 61000-6-2 および IEC 61000-6-2 に準拠して、工業用途に承認されている I/O 装置のみを接続してください。
- ホットプラグ接続のできない I/O 装置は、装置を電源から切り離れた後に限って接続することができます。

通知

回生フィードバックによる損傷

接続または設置されたコンポーネントによる対地電圧の回生フィードバックによって、装置が破損する可能性があります。

接続または内蔵された I/O、たとえば USB ドライブでは、装置に電圧を提供することができません。

回生フィードバックは、通常許可されません。

注記

逆起電力を測定するときは、以下のことに注意してください。

- 問題の IPC の電源をオフにして、電源コネクタを挿したままにする必要があります。
- 測定中は、プラントから IPC へのすべてのケーブルは接続しておくべきです。
- プラントの他のすべての構成部品が作動状態であることが必要です。

2.6 タッチスクリーンについての注意事項

 警告

正しくない操作による人身傷害または物的損傷

タッチスクリーン搭載装置の誤った操作が発生することがあります。その結果、人身傷害や物的損傷が発生することがあります。

以下の予防策を講じる必要があります。

- プラントを設定して、タッチスクリーンで安全関連の機能が操作されないようにする。
- クリーニングおよびメンテナンスの際は装置のスイッチをオフにする。
- タッチスクリーンにほこりが掛からないようにする。

通知

タッチスクリーンの損傷

硬い物体で衝撃を与えたり、先のとがった、鋭い物体を使ってタッチスクリーンをタッチすると、スクリーンを損傷し、寿命を大幅に縮めたり、タッチスクリーンを完全に損傷させてしまうことがあります。

先の尖った物やよく切れる物で、タッチスクリーンに触れないでください。タッチスクリーンに触れる場合には、指、タッチスタイラスまたは承認されたタッチ手袋を必ず使用します。

誤動作防止



警告

保護導体がないことによる人身傷害や物的損傷

不適切な保護導体またはそれが欠落しているため、抵抗性マルチタッチスクリーンの誤動作を招くことがあります。機能が適切に動作しないことがあります。その結果、人身傷害や物的損傷が発生することがあります。

- 常に保護導体に装置を接続します。
- 保護導体の接続に関する追加情報については、「保護導体の接続 (ページ 45)」セクションを参照してください。



注意

タッチスクリーン操作の意図しない挙動

システムの内部プロセス実行中にタッチスクリーンに触れると、装置の意図しない反応が引き起こされる場合があります。

以下の場合にはスクリーンに触れないでください。

- 起動プロセス中
- USB コンポーネントのプラグ中またはアンプラグ中
- スキャンディスクの実行中
- BIOS 更新中

2.7 装置およびシステム拡張に関する注意事項

装置およびシステム拡張



注意

装置の過熱による火災の危険

拡張カードにより、追加熱が発生します。装置は、過熱したり火災の原因になる可能性があります。

- 拡張カードの安全および設置手順に従ってください。
- 当該装置の最大許容電力消費値を順守してください。
- 疑わしい場合は、規格 IEC/UL/EN/DIN-EN 61010-2-201 の 9.3.2 項の要件を満たす筐体内に装置を設置します。

通知

装置およびシステム拡張が原因の損傷

装置およびシステムの拡張は障害を含む場合があります。装置、機械またはプラント全体に影響を及ぼす可能性があります。これらは、無線干渉抑制に関する安全規則に違反する場合があります。

装置またはシステムの拡張を設置または交換し装置が損傷した場合は、保証が無効になります。

- 装置を開ける前に必ず電源プラグを外してください。
- 本装置用に設計された装置またはシステムの拡張のみを設置します。
- 技術仕様に提供されている「電磁環境適合性」に関する情報に注意してください。

技術サポートチームまたは販売店に連絡して、設置に適する装置およびシステムの拡張を確認してください。

責任の制限

- 関連するマニュアルの拡張コンポーネントの設置手順を順守してください。
- 本装置の UL 規格の認定は、UL 認定部品を「適合条件」に従って使用した場合に限って適用されます。
- 我々は、サードパーティ製の装置またはコンポーネントの使用によって生じた機能の制限について責任を負うものではありません。

装置の設置と接続

3.1 設置準備

3.1.1 納品範囲

装置および装置のハードウェア

- Panel PC SIMATIC IPC PX-32A
- 12 × 取り付けクリップ
- 1 × USB フラッシュドライブ、復元またはドキュメンテーションとドライバのセット付き(オプション、注文した場合)

オペレーティングシステム

注文した装置設定に基づいて、装置は、インストール済みオペレーティングシステムがありまたはなしで装備されます。

注文した Microsoft® Windows®オペレーティングシステムに関する情報は次で参照できます。装置を操作するための重要な指示およびマニュアル (ページ 9)またはオペレーティングシステムの技術仕様 (ページ 85)。

インストールされているソフトウェア

- ソフトウェアのモニタリング(インストール済みの Microsoft® Windows®オペレーティングシステムのみ使用)

装置の追加ソフトウェアに関する最新の情報は、付属品とスペア部品 (ページ 17)で参照できます。

印刷されたドキュメント

- クイックインストールガイド SIMATIC IPC PX-32A
- 製品情報「お使いの装置に関する重要な注意事項」

3.1 設置準備

3.1.2 納品パッケージの確認



破損した装置が原因の電氣的衝撃および火災の危険

不適切な保管または輸送によって損傷された装置は、作業者のけがや装置への重大な損害を引き起こすことがあります。

- 「輸送と保管に関する注意事項 (ページ 22)」の警告を順守してください。

手順

1. 納入されたユニットに目視可能な輸送による損傷の兆候がないかチェックします。
納品時に輸送による損傷が見つかった場合、担当の出荷会社に対して苦情を申し立ててください。直ちに輸送中の損傷状況を搬送者に確認させてください。
2. 取り付け場所で装置の梱包を解いてください。
3. 再度ユニットを運搬する必要が生じたときのために、元の梱包材を保管しておいてください。
4. 納品範囲 (ページ 31) と付属品について、注文した内容が全部揃っているかと破損がないかを確認します。

パッケージの内容が不完全、損傷しているまたは注文内容に対応しない場合、アフターサービス情報システム (ASIS) (<http://siemens.com/asis>) を使用して製品の納入や修理についてのフィードバックを送信できます。

「製品納入:品質管理と修理のフィードバック」の見出しのある製品納品用のオンラインフォーム (品質管理通知) に入力します。
5. マニュアルは安全な場所に保管してください。それは、初回コミッショニングに必要であり、装置の一部です。
6. 装置のデータの識別 (ページ 33) を書き留めてください。

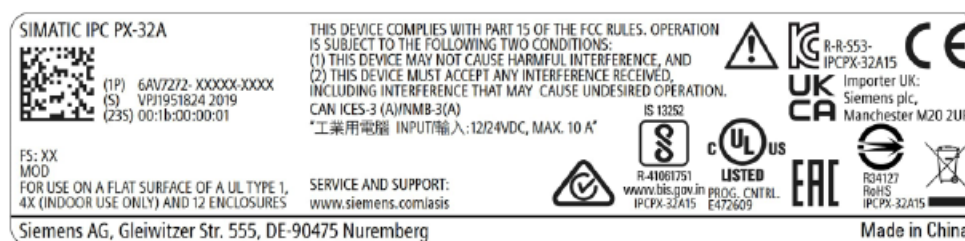
3.1.3 装置のデータの識別

装置は、修理が必要だったり、紛失した場合は、この識別データを使用して一意に識別することができます。

次の図に例を示します。装置のデータは、これらの例のデータとは異なる場合があります。

銘板

次の画像は、例として、SIMATIC IPC PX-32A の銘板を示しています。



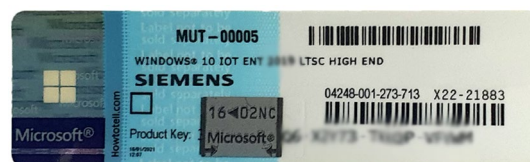
COA ラベル

COA (Certificate of Authenticity)ラベルは、装置の側面にあります。

注記

COA ラベルは、Microsoft® Windows®オペレーティングシステムがインストールされて出荷される装置のみに使用可能です。

Microsoft® Windows® 10 オペレーティングシステムの COA ラベルの例:



3.1 設置準備

3.1.4 据え付け位置

通知
<p>IEC/EN/UL61010 に準拠して承認</p> <p>本装置は、IEC/UL/EN/DIN-EN 61010-1 および IEC/UL/EN/DIN-EN 61010-2-201 の 9.3.2. c)項による防火筐体の要件を、標準取付位置、水平形式での取付、最大傾斜角±45°でのみ満たしています(図を参照)。</p> <p>IEC/UL/EN/DIN-EN 61010-1 および IEC/UL/EN/DIN-EN 61010-2-201 の 9.3.2. c)項に準拠した筐体に設置した場合、装置を垂直モードで動作させることもできます。装置は、これで「開放型装置」として分類されます。</p>

通知
<p>6 コアおよび 8 コアプロセッサ(Intel Xeon W-11555MLE 搭載の 6AV7272-5....-....および Intel Xeon W-11865MLE 搭載の 6AV7272-7....-....)を搭載した装置に対する IEC/EN 61010 に準拠した承認</p> <p>本装置は、IEC/EN/DIN-EN 61010-1 および IEC/EN/DIN-EN 61010-2-201 の 9.3.2. c)項による防火筐体の要件を、標準取付位置、水平形式での取付、最大傾斜角±45°でのみ満たしています(図を参照)。</p>

注記

閉め切った室内での操作

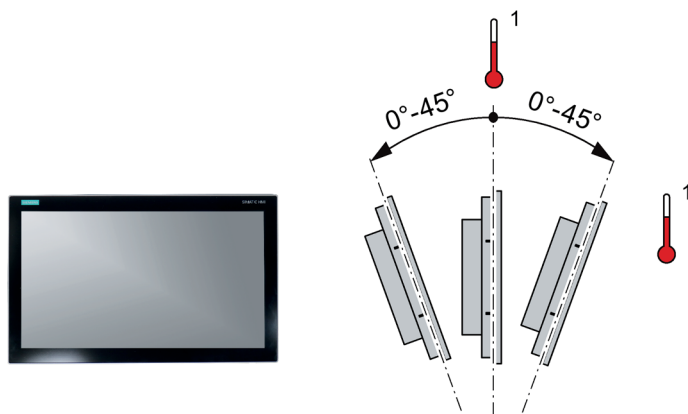
装置は閉め切った室内での操作についてのみ承認されています。

下記の据え付け位置は、この装置用に許可されています。

操作中の最高許容周囲温度についての情報は、「周辺環境 (ページ 81)」セクションを参照してください。

水平形式での取付

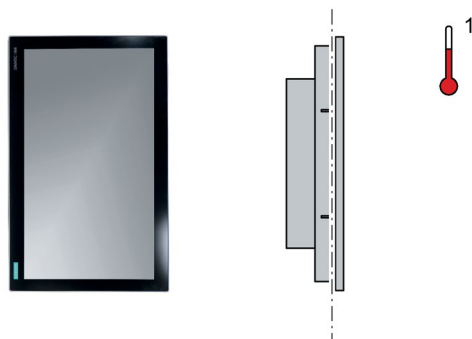
水平形式での垂直取り付け、または垂直方向に最大 $\pm 45^\circ$ の傾斜をつけた水平形式での傾斜取り付け:



¹ 温度仕様については、「周辺環境 (ページ 81)」セクションを参照してください。

垂直フォーマットでの取り付け

垂直フォーマットでの直立取り付け:



¹ 温度仕様については、「周辺環境 (ページ 81)」セクションを参照してください。

電源は上部にあります。

3.1 設置準備

3.1.5 取り付けカットアウトの準備

注記

安定した取り付けカットアウト

取り付けカットアウト周囲の素材には十分な強度があり、HMI デバイスをできるだけ確実に長期間に安全に取り付けられることが必要です。

クランプの強度が不十分なために、デバイスの操作によって素材を変形し、以下の保護基準値に達しないようにならないように注意します。

注記

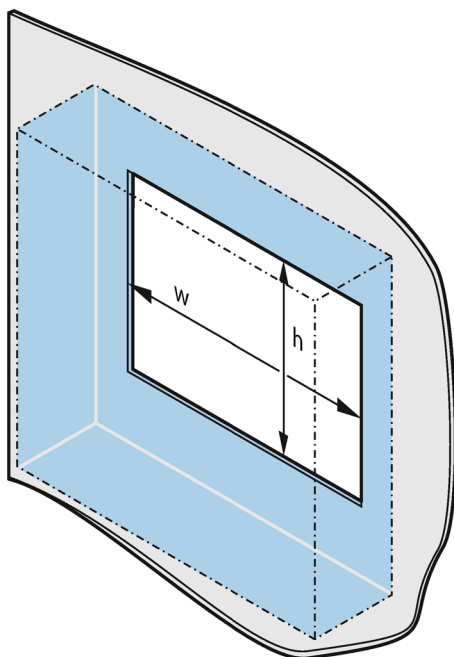
「設置のガイドライン (ページ 38)」セクションの情報をお読みください。

保護等級に準拠するための要件

HMI 装置の保護等級は、次の要件を満たした場合に限り保証されます。

- 保護等級 IP65 または Enclosure Typ 4X/Typ 12 (indoor use only) で規定されている取り付けカットアウトでの素材の厚さ: 2 mm ~ 6 mm
- 取り付けカットアウト平面からの許容偏差: ≤ 0.5 mm
取り付ける HMI デバイスのためにこの条件が満たされている必要があります。
- 取り付けるシールのエリア内の許容表面粗さ: ≤ 120 μm (Rz 120)

取り付けカットアウトの寸法



取り付けカットアウト	マルチタッチ装置			
	12"	15"	19"	22"
幅 w^1	302 ⁺¹ mm	388 ⁺¹ mm	455 ⁺¹ mm	522 ⁺¹ mm
高さ h^1	208 ⁺¹ mm	241 ⁺¹ mm	279 ⁺¹ mm	317 ⁺¹ mm

¹ 幅と高さは、垂直フォーマットに取り付けるときは、入れ替えます。

設置の奥行き

全体の奥行きに関する情報については、「寸法図 (ページ 86)」セクションを参照してください。

3.2 装置の設置

3.2 装置の設置

3.2.1 設置のガイドライン

設置中および取り付け中の手順



警告

危険な電圧および火災の危険

設置および取り付け中の不適切な行動は、作業者のけがや装置への重大な損害を引き起こすことがあります。

下記の設置および組立に関する注意事項を順守する必要があります。

- 取り付けに関する注意 (ページ 23)
- 周辺条件および環境条件に関する注意事項 (ページ 24)

通知

耐荷重能力の不足

取り付けられる壁に十分な耐力がない場合、装置が落下し、破損する可能性があります。

- 壁の取り付け面が、固定部品を含めた装置の総重量の 4 倍の重量に耐えられることを確認してください。

通知

不適切な固定部品

以下に取付用に指定される以外の固定具を使用した場合、装置がしっかりと固定されない可能性があります。装置が落下して損傷する可能性があります。

- 指定された固定具のみを使用します。

注記

- 「取り付けカットアウトの準備 (ページ 36)」にある注意事項を参照してください。
 - 制御キャビネットの取り付けについては、SIMATIC セットアップガイドライン、関連する DIN/VDE 要件または当該国固有の規則に留意してください。
 - 換気および熱輸送向けに適切な容量を制御キャビネット内に提供します。装置と制御キャビネットの間は最低 50 mm 離してください。
 - 装置の換気スロットは、覆ったり塞いだりしないでください。
 - バックプレーンカバーを取り外すための十分なクリアランスが制御キャビネット内にあることを確認します。
 - 取り付けカットアウトの安定化用に制御キャビネットにストラットを取り付けます。必要に応じてストラットを取り付けます。
-

下記も参照

据え付け位置 (ページ 34)

3.2 装置の設置

3.2.2 取り付けクリップを使用した装置の取り付け

取り付けクリップの位置

装置の保護等級を達成するには、以下に示す取り付けクリップの位置を順守する必要があります。

必要条件

- すべての梱包用部品とカバーホイルが装置から取り外されていること。
- 装置を取り付けるための、付属品キットに入っている取り付けクリップがあること。
- 装置の前面の取り付けシールが管理されていないこと。

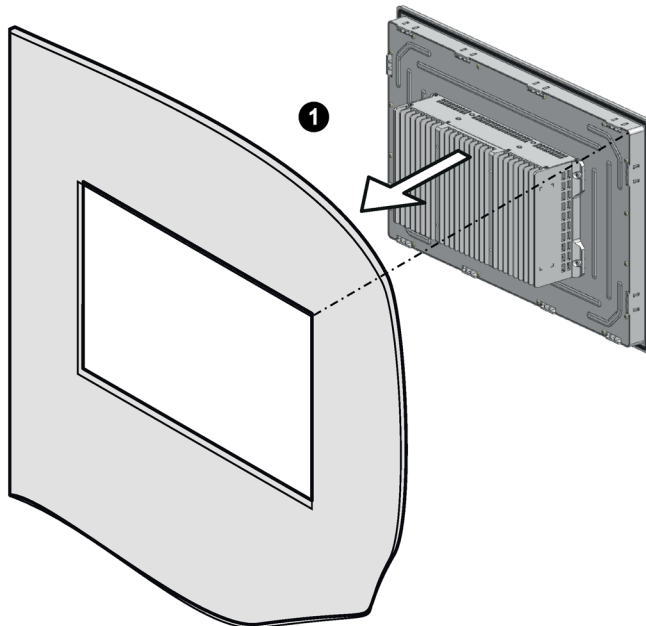
手順

注記

取り付けシールが破損していたり、装置から突出している場合は、保護等級の保証は確認されません。

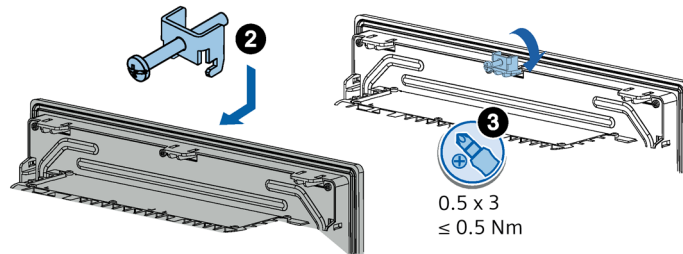
取り付けシールが損傷を受けている場合、装置を取り付けることは禁止されています。

1. 正面から取り付け、取り付けカットアウトに装置を挿入します。



2. 取り付けクリップを、装置のカットアウトに挿入します。

取り付けクリップの正しい位置に注意してください。



3. 取り付けクリップを固定するには、マイナススクレュードライバを使用して止めネジを締め付けます(トルク 0.5 Nm)。
4. すべての取り付けクリップで、ステップ 2 からステップ 3 を繰り返します。
5. 取り付けシールの状態を確認してください。

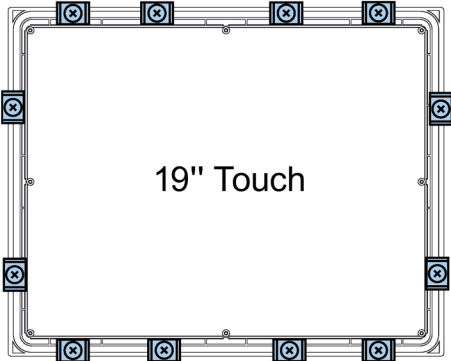
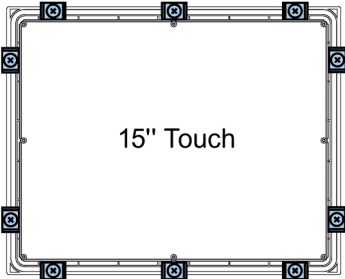
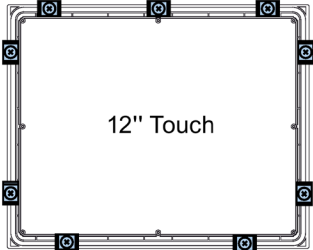
マルチタッチ装置の取り付けクランプの位置

取り付けクリップを図示されている位置に固定します。取り付けクリップの数はデバイスによります。

22" (12 x), 19" (12 x), 15" (10 x), 12" (9 x)

装置	位置
22"ディスプレイ	<p style="text-align: center;">22" Touch</p>

3.2 装置の設置

装置	位置
19"ディスプレイ	 <p>19" Touch</p>
15"ディスプレイ	 <p>15" Touch</p>
12 インチディスプレイ	 <p>12" Touch</p>

3.2.3 VESA アダプタを使用した装置の固定

100 x 100 mm VESA アダプタを使用して、最大 24"のサイズのディスプレイを搭載する SIMATIC IPC PX-32A を固定することもできます。

VESA アダプタの異なるモデルは、サードパーティのメーカーから提供されます。

通知

IEC/EN/UL61010 に準拠して承認

本装置は、IEC/UL/EN/DIN-EN 61010-1 および IEC/UL/EN/DIN-EN 61010-2-201 の 9.3.2. c)項による防火筐体の要件を、標準取付位置、水平形式での取付、最大傾斜角 $\pm 45^\circ$ でのみ満たしています(図を参照)。

VESA アダプタを使用して垂直取り付け位置で装置を使用することは、UL61010-2-201 の範囲内では許可されていません。

通知

6 コアおよび 8 コアプロセッサ(Intel Xeon W-11555MLE 搭載の 6AV7272-5....-....および Intel Xeon W-11865MLE 搭載の 6AV7272-7....-....)を搭載した装置に対する規格 IEC/EN61010 に準拠した承認

本装置は、IEC/EN/DIN-EN 61010-1 および IEC/EN/DIN-EN 61010-2-201 の 9.3.2. c)項による防火筐体の要件を、標準取付位置、水平形式での取付、最大傾斜角 $\pm 45^\circ$ でのみ満たしています(図を参照)。

通知

装置全体の保護等級

VESA アダプタを使用して装置を固定する場合、装置の保護等級 IP65 が失われます。スプレーや水ジェット、さらには侵入物質によって、装置が損傷されることがあります。

通知

VESA アダプタの寸法

VESA アダプタを選択するとき、装置の重量の 4 倍以上の重量に対して設計されていることを確認してください。

3.2 装置の設置



警告

装置は安全に取り付けられる必要があります。

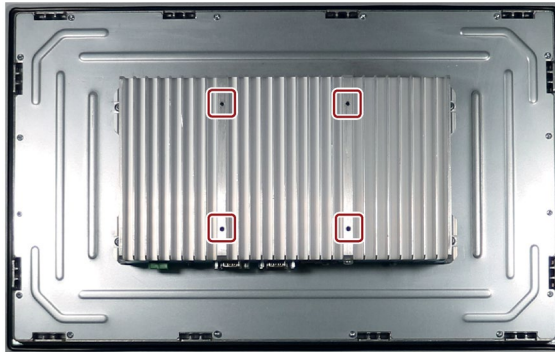
不十分な寸法の締め付け具を使用すると、装置の落下を招く場合があります。結果として、重大なケガを招くことがあります。

装置の取り付け中に、締め付け具が適切な寸法であることを確認してください。締め付け具の寸法を決めるときは、装置の重量および装置に掛かる力を考慮に入れてください。これは、装置の動的負荷に特に当てはまります。取り付け表面、サポートアームシステム、およびネジなどの締め付けエレメントを含むすべての締め付け具は、装置重量の4倍以上の負荷に耐えられる必要があります。

装置を使用する場所に適用される他の法的仕様および装置の固定に関連して適用される他の規制を順守してください。

手順

1. マークされた場所に VESA アダプタ 100 x 100 mm を取り付けます。
2. これを行うには、プロパティクラス 8.8 の M4x10 ネジを使用し、3 Nm のトルクでこれらを締め付けます。



3.3 装置の接続

3.3.1 保護導体の接続

装置を保護するために、保護導体接続が必要です。保護導体は、危険な電流を放電し、サージ保護スイッチを起動させます。さらに、保護導体は、外部電源ケーブル、信号ケーブルまたは I/O 装置から接地までのケーブルによって生成される干渉電流の放電も向上します。

保護導体の接続には、以下のシンボルがラベル付けされます。

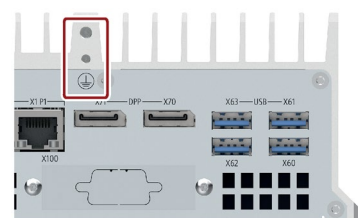


必要条件

- 装置が設置されていること。
- 1 × 保護導体、最小断面積 2.5 mm² = AWG14
- 1 × T20 スクリュードライバ
- 1 × M4 ケーブルラグ

手順

1. ケーブルラグを保護導体に押し付けます。
2. 図示されているように、ケーブルラグを保護導体接続部にねじ込みます。



3. 保護導体を、装置が取り付けられている制御キャビネットの保護導体接続部にワイヤ接続します。

3.3 装置の接続

3.3.2 電源の接続

3.3.2.1 端子の接続

電源を接続するための接続端子は、装置に取り付けられます。

- 接続端子は、断面積が 0.25 mm² ~ 最大 4 mm² の穴用に設計されています。
- 断面積が 1.5 mm² 以上、温度定格が 85 °C 以上である銅ケーブル(Cu)のみを接続してください。
- 半剛体または柔軟ケーブルのいずれかを使用できます。
- エンドスリーブを使用する必要はありません。

必要条件

- 外部の 9-36 V DC 電源のスイッチを切ります。
- 1 x 接続端子
- 1 0.6 x 3.5 mm プラスドライバー

手順

通知
装置の損傷 装置にプラグ接続するとき、接続端子のネジを調整しないでください。 接続端子およびソケットのスクレイドライバの圧力によって装置を損傷することがあります。 • プラグ接続しないときは、接続端子にワイヤを接続します。

注記

穴が正しい端子に接続されていることを確認してください。装置の接点にあるラベルに従ってください。

**注意**

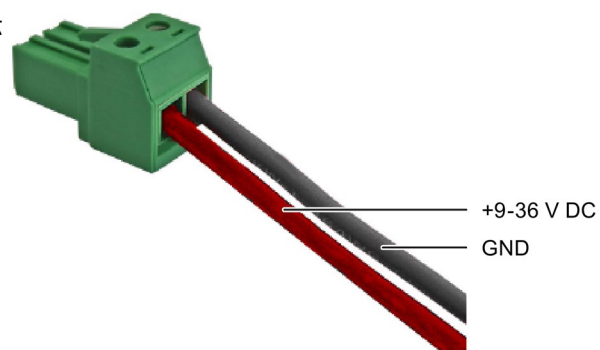
端子接続には銅ケーブルを使用します。

端子経由でのデバイスへのすべての電源ラインには、銅(Cu)ケーブルを使用します。例えば、24 V DC 電源ケーブルを 24 V DC 電源端子に使用します。

Utiliser des câbles en cuivre sur les connexions à bornes

Utilisez des câbles en cuivre (Cu) pour tous les câbles d'alimentation qui sont raccordés à l'appareil par des bornes, par exemple les câbles d'alimentation 24 V CC sur le connecteur d'alimentation 24 V CC.

1. 0.6 Nm の締め付けトルクで、図示されているようにケーブルを接続します。図示されているように接続端子が正しい位置にあることを確認してください。



3.3 装置の接続

3.3.2.2 9 -36 V DC 電源の接続

次に注意して、装置の安全な操作および規制への準拠を確証してください。

 **警告**

安全規制 - 接続ケーブル

地域の安全規制に準拠した DC 接続ケーブルのみを使用します。

そうでない場合、火災および感電のリスクがあります。その結果、人身傷害や物的損傷が発生することがあります。

- DC 接続ケーブルが、装置が設置される国の安全規則に準拠しており、それぞれの場合に必要なマークを表示していることを確認してください。
- 取扱説明書に従って、保護コンダクタを接続してください。

 **警告**

感電のリスク

オン/オフスイッチでは、装置はライン電圧から完全に切り離されません。

装置または接続線に損傷がある場合、火災が発生するリスクもあります。

- 装置に対して作業を実施する前、または装置を長期間使用しないときは、装置を必ずライン電圧から完全に切り離してください。
- 制御キャビネットの取り付け:可能な場合、装置の近くで、集中化された、簡単にアクセス可能な AC 回路ブレーカーを使用します。
- 装置を設置するとき、電源コネクタに簡単にアクセスできるようにします。

通知

IEC/EN/UL61010 に準拠して承認

- 装置は、IEC/UL/EN/DIN EN 61010-2-201 規格に準拠した、安全特別低電圧 (SELV/PELV)の要件を満たしている 24 V DC 電源にのみ接続できます。電源は、IEC/UL/EN/DIN EN 61010-2-201 に準拠した NEC Class 2 または Limited Energy の要件を満たしている必要があります。
- 装置が IEC/UL/EN/DIN-EN 61010-1 および IEC/UL/EN/DIN-EN 61010-2-201 の 9.3.2. c)項に準拠した筐体に設置された場合、装置には「NEC Class 2 / Limited Energy 以上」の電源から給電することができます。装置は、これで「開放型装置」として分類されます。

通知

6 コアおよび 8 コアプロセッサ(Intel Xeon W-11555MLE 搭載の 6AV7272-5....-....および Intel Xeon W-11865MLE 搭載の 6AV7272-7....-....)を搭載した装置に対する IEC/EN 61010 に準拠した承認

- 本装置は、IEC/EN/DIN-EN 61010-2-201 規格に準拠して、安全特別低電圧 (SELV/PELV)の要件を満たしている 24 V DC 電源にのみ接続できます。電源は、NEC Class 2 または IEC/EN/DIN-EN 61010-2-201 で指定されている Limited Energy 要件を満たしている必要があります。

注記**逆極性保護**

9-36 V DC 電源は、逆極性保護の特性があります。9-36 V DC 接続ケーブルと接地を混同すると、装置は損傷されませんが、スイッチがオンになりません。電源が正しく接続されると、装置は再び操作可能になります。

必要条件

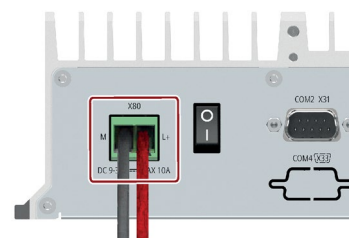
- 装置が設置されていること。
- 保護導体の接続 (ページ 45)が接続されています。
- 1 線 端子の接続 (ページ 46)。

関連する 9-36 V DC 電源のスイッチを切ります。

- 1 0.6 × 3.5 mm プラスドライバー

手順

1. 装置が誤って起動するのを防ぐために、電源コードのプラグを差し込むときは、オン/オフスイッチが「0」位置(オフ)にあることを確認します。
2. マークが付いた位置の端子に挿入します。



3.3 装置の接続

3.3.3 I/O 装置の接続



注意

I/O 装置が原因の故障

I/O 装置の不適切な接続は、装置の故障の原因になる可能性があります。

負傷および機械やプラントの損傷につながる場合があります。

- 「I/O デバイスに関する情報 (ページ 27)」の I/O 装置の接続に関連する警告を順守する必要があります。

手順

注記

アダプタまたは拡張機能なしで、接続対象の I/O のオリジナル接続を使用します。

1. I/O 装置を該当するインターフェースに接続します。

インターフェースの位置に関する情報は、「インターフェースおよび操作エレメント (ページ 14)」で入手可能です。

2. ストレインリリーフを使用してケーブルを固定します。

参照: ケーブルの固定 (ページ 53)

複数のモニタの接続(マルチモニタリング)

モニタの接続用に装置前面に 2 つのポートがあります。これらのポートは、マザーボードに接続されます。

パラメータ割り付けは、Windows®のコントロールパネルで実施します。

IPC は、マルチモニタリング用に工場設定されます。必要な場合、ファームウェア/BIOS 設定で、マルチモニタリング機能およびブートスクリーンの出力を設定できます。

次の表に、装置インターフェースのモニタに対する様々な接続オプションを表示します。

		マザーボード	
		DPP1	DPP2
モニタ 1	DP	X	-
	DVI	X ¹⁾	-
	VGA	X ²⁾	-
モニタ 2	DP	-	X
	DVI	-	X ¹⁾
	VGA	-	X ²⁾

1) - DP 経由の DVI-D アダプタ

2) - DP 経由の VGA アダプタ

3.3 装置の接続

3.3.4 ネットワークへの装置の接続

以下のオプションは、既存または計画中のシステム環境/ネットワークへの統合に使用することができます。

Ethernet

自動化装置(SIMATIC S7 等)との通信やデータ交換用に、統合 Ethernet インターフェース(10/100/1000 Mbps)を使用できます。

これには、「SOFTNET S7」ソフトウェアパッケージが必要です。

PROFINET

PROFINET は、以下を介して操作できます。

- 標準 Ethernet インターフェース(RT)

SIMATIC NET

このソフトウェアパッケージを使用すると、フィールドアンドコントロールレベルの革新的ネットワークを作成、操作、および設定することができます。この点についての詳細情報は、SIMATIC NET (<http://w3.siemens.com/mcms/automation/en/industrial-communications/Pages/Default.aspx>)を参照してください。

ソフトウェアパッケージとマニュアルは、この納品範囲に含まれていません。

追加情報

詳細については、インターネットの次のサイトで参照できます。技術サポート (<https://support.industry.siemens.com>)

3.3.5 ケーブルの固定

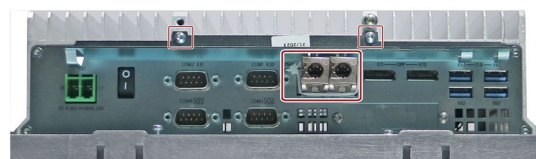
納入されるストレインリリーフ(「納品範囲 (ページ 31)」を参照)は、装置からインターフェースケーブルが予期せずゆるむことを防止します。

必要条件

- I/O デバイスは、対応するインターフェースに接続されます。
- 1 x Torx T10 型ネジまわし
- 1 x ケーブルグリップ(納品範囲に含まれていない)
- ケーブルタイ(納品範囲に含まれていない)
- 2 x ネジ(納品範囲に含まれていない)

手順

1. 同梱された皿ネジを使用してマークされた位置でストレインリリーフを取り付けます。
2. ケーブルタイをストレインリリーフバーの周囲に通し、図示されているようにケーブルを固定します。
3. ケーブルタイの突出している端を切り取ります。



装置のコミッショニング

4.1 装置の電源スイッチ投入

必要条件

- 電源が接続されていること。

手順

1. 装置の前面にあるオン/オフスイッチをオンに切り替えます(「_」シンボルが押されているときは「オン」位置です)。

スイッチの位置に関する情報は、「インターフェースおよび操作エレメント (ページ 14)」で参照できます。

インストール済みの Windows®オペレーティングシステムのコミッショニング

装置の初回起動およびインストール済みの Windows®オペレーティングシステムのコミッショニングに関する情報は、そのマニュアルで参照できます。

これについての詳細は、「装置を操作するための重要な指示およびマニュアル (ページ 9)」も参照してください。

4.2 装置をオフにする

オペレーティングシステムのシャットダウン

アクティブなオペレーティングシステムの場合

- オペレーティングシステムを正しくシャットダウンします。

結果

装置はオフになりますが、ライン電圧から完全に接続解除されていません。

装置のライン電圧からの完全な接続解除



警告

感電のリスク

オン/オフスイッチでは、装置はライン電圧から完全に切り離されません。

装置または接続線に損傷がある場合、火災が発生するリスクもあります。

- 装置に対して作業を実施する前、または装置を長期間使用しないときは、装置を必ずライン電圧から完全に切り離してください。
- 制御キャビネットの取り付け:可能な場合、装置の近くで、集中化された、簡単にアクセス可能な AC 回路ブレーカーを使用します。
- 装置を設置するとき、電源コネクタに簡単にアクセスできるようにします。

- オペレーティングシステムをシャットダウンし、電源プラグを装置の前面から外します。「インターフェースおよび操作エレメント (ページ 14)」を参照してください。

装置はオフになり、ライン電圧から完全に接続解除されます。トリクル電流は流れません。

4.2 装置をオフにする

ハードウェアリセット

ハードウェアのリセットにより、キーボードやマウス入力への応答がなくなった場合に、装置を再起動できます。実行中のオペレーティングシステムは、安全にシャットダウンされません。

通知
<p>データの損失</p> <p>ハードウェアリセットが実行される場合、装置は強制再起動を実行します。</p> <ul style="list-style-type: none">• メインメモリのデータは削除されます。• ハードディスクドライブのデータは失われます。• 装置が破損することがあります。 <p>ハードウェアリセットは、緊急時のみ実行してください。</p>

- オン/オフスイッチを操作して、ハードウェアリセットを作動させます。「インターフェースおよび操作エレメント (ページ 14)」を参照してください。

下記も参照

一般的な安全上の注意事項 (ページ 19)

デバイスの操作

5.1 可能な操作

お使いの装置または接続済みの I/O 装置により、以下の操作が利用可能です。

- タッチ装置用タッチスクリーン



タッチスクリーン操作の意図しない挙動

システムの内部プロセス実行中にタッチスクリーンに触れると、装置の意図しない反応が引き起こされる場合があります。

以下の場合はスクリーンに触れないでください。

- 起動プロセス中
 - USB コンポーネントのプラグ中またはアンプラグ中
 - スキャンディスクの実行中
 - BIOS 更新中
- タッチ装置用スクリーンキーボード
 - 外部キーボード、USB 経由で接続
 - 外部マウス、USB 経由で接続

下記も参照

タッチスクリーンについての注意事項 (ページ 28)

5.2 Trusted Platform Module (TPM)

お使いの装置には、TPM 2.0 規格に準拠した Trusted Platform Module があります。Trusted Platform Module は、装置をセキュリティ機能で強化するチップです。これは、例えば、PC の操作からの保護を強化しています。

通知

Trusted Platform Module の輸入制限

Trusted Platform Module の使用は、一部の国では法規制の対象となっており、許可されていません。

- 装置が使用される国の関連する輸入制限を必ず順守してください。

Trusted Platform Module の有効化

Trusted Platform Module の有効化に関する情報は、詳細なファームウェア/BIOS 説明で参照できます。「装置を操作するための重要な指示およびマニュアル (ページ 9)」を参照してください。

パラメータの装置への拡張および割り当て

6.1 装置を開く



警告

未許可で開いて、不適切な修理や拡張を行うことによるリスク

拡張するときに不適切な手順で行うと、装置を破損したりユーザーを危険にさらす恐れがあります。

システム拡張を取り付けたり交換したりして装置を破損した場合は、保証が無効になります。

- この理由で、「装置およびシステム拡張に関する注意事項 (ページ 30)」の情報を順守してください。



警告

誤作動および感電

装置に不適切な介入を行うと、操作の信頼性を脅かし、装置を損傷することがあります。

これは、怪我やプラント損傷の原因となることがあります。

以下の予防策を講じる必要があります。

- 装置を開ける前に電源プラグを外してください。
- 介入が終わるごとに装置を閉めます。

通知

静電放電により破損する恐れのある部品(ESD)

装置には、静電気によって破損する可能性のある電子部品が内蔵されています。これは、機械やプラントの故障や損傷が生じるおそれがあります。

装置を開く前に、対応する予防措置を講じる必要があります。

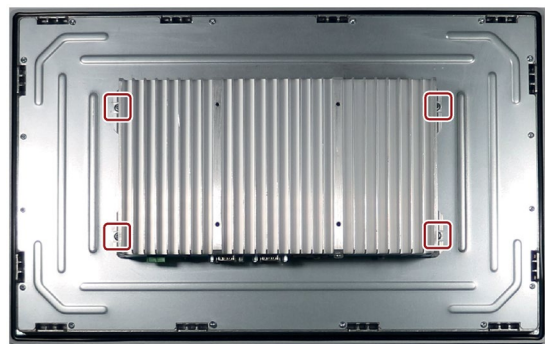
6.1 装置を開く

必要条件

- 装置がライン電圧から完全に接続解除されていること。「装置をオフにする (ページ 55)」を参照してください。
- すべての接続ケーブルが抜かれていること。
- Torx T10 型ネジまわし

手順

1. マーク付きのネジを取り外します。



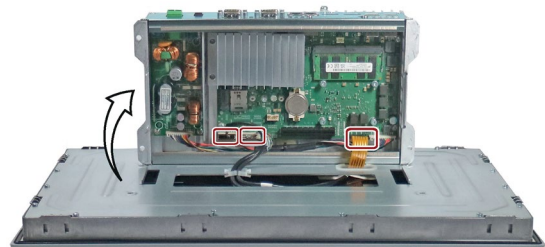
2. タッチパネルから PC の筐体を傾けます。

3. マザーボードから 3 本のマークされたケーブルを外します。

注記:金色の右のフォイルケーブルを事前にロック解除する必要があります。

4. 前面パネルを置きます。

逆の順序で装置を閉じます。



6.2 拡張モジュール(M.2)

6.2.1 使用可能な拡張モジュール(M.2)

拡張モジュール(M.2)は、以降では、「M.2 モジュール」と呼ばれています。

以下の仕様に準拠した M.2 モジュールがサポートされています。

	M.2 モジュール 1 (X100)
寸法	2230、2242、2260、3030、3042
インターフェース	Key B
プロトコル	1 × PCIe 3.0 x2 lane 1 × USB 2.0
WLAN モジュール ¹ 、例 WiFi	x
WWAN モジュール、例 LTE/ 5G	x
Field Bus	x
M.2 NVMe SSD	-
Artificial Intelligence	x
Special (Digital IO)	x

¹ E キー/A+E キーも M.2 キーの E キー-B アダプタから可能です

M.2 モジュールの使用条件

- M.2 モジュールの寸法は、指定された寸法を超過することはできません。寸法が超過している場合、接触の問題、誤作動および組み立ての困難などをもたらすことがあります。
- M.2 モジュールとコンディショナカードの間の接続ケーブルの長さは、少なくとも 150 mm にする必要があります。

下記も参照

マザーボードのインターフェース位置 (ページ 98)

拡張モジュールの寸法図(M.2) (ページ 90)

6.2 拡張モジュール(M.2)

6.2.2 拡張モジュールの取り付け/取り外し(M.2)

注記

M.2 モジュールの要件

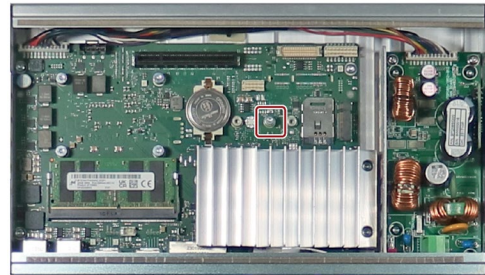
- M.2 モジュールの許容寸法については、「使用可能な拡張モジュール(M.2) (ページ 61)」で参照できます。許容される高さを超過する場合、接触問題、誤作動および取り付けの問題を無視できません。
 - スロットに取り付け可能な M.2 モジュールに関する情報は、「使用可能な拡張モジュール(M.2) (ページ 61)」で参照できます。
-

必要条件

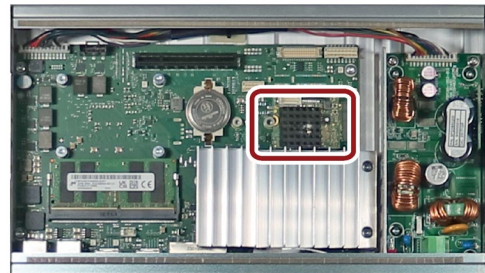
- M.2 モジュールおよび M.2 モジュールの使用条件に関する情報に精通していること。「使用可能な拡張モジュール(M.2) (ページ 61)」を参照してください。
- 装置が開いた状態であること。これに関する重要な情報については、「装置を開く (ページ 59)」を参照してください。
- アダプタプレート:使用される M.2 モジュールに外部インターフェースがある場合、M.2 モジュールに同梱されているアダプタプレートを使用してコネクタを取り付けることができます。
- Torx T10 型および T8 型ネジまわし

手順 - 設置

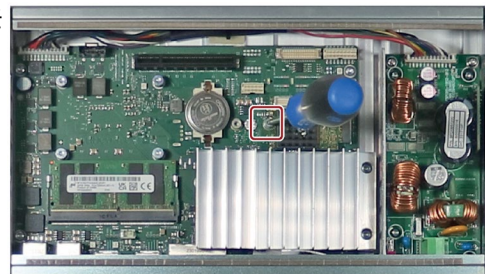
1. Torx T8 型のネジまわしを使用して、マザーボードの指定されたネジを外します。



2. M.2 モジュールを対応するスロットに挿入します(X100)。
これを行うとき、M.2 モジュールの接点に触らないようにします。



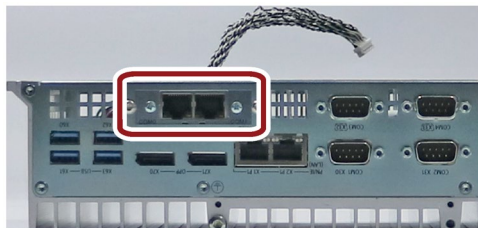
3. 最初の手順で取り外したネジで M.2 モジュールを固定します。
純正のネジのみをスペーサと一緒に使用します。
注記:ネジの頭とスペーサの間に M.2 モジュールが来るようにしてください。



6.2 拡張モジュール(M.2)

M.2 モジュールに筐体開口部に接続される必要がある追加のインターフェースカード付きケーブルが含まれている場合、次の手順も実行する必要があります：

4. Torx T10 スクリュードライバを使用して、ブラッキングカバーを固定するための、マークが付いているネジを緩めます。
5. 内側から追加のインターフェースカードを使用されていない筐体開口部に配置し、ネジを使用してこれを固定します。
6. インターフェースカードのケーブルを M.2 モジュールに接続します。



7. 「装置を開く (ページ 59)」のセクションで指定されているように装置を閉じます。

手順 - 取り外し

取り付けの逆の手順を実行してください。

BIOS Setup の設定

BIOS Setup の設定が必要になる場合があります。インストールに関する詳細情報については、指定されている拡張モジュールに同梱されているマニュアルを参照してください。

下記も参照

M.2 NVMe SSD の交換 (ページ 67)

6.3 メモリモジュール

6.3.1 メモリモジュールの取り付けおよび取り外し

マザーボードには、SO-DIMM DDR4 メモリモジュール用のスロット 1 つが搭載されています。これを使用して、装置のメモリ容量を最大 32 GB まで拡張することができます。

使用可能なメモリモジュール

- DIMM DDR4 メモリモジュール
- メモリ転送速度: 3200 MT/秒(バッファなし)
- 「ECC なし」

注記

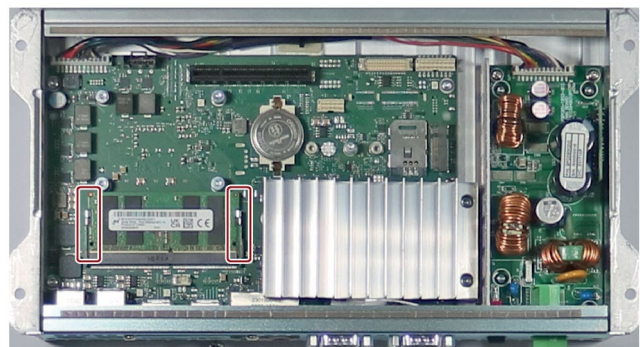
Siemens AG によって推奨されているメモリモジュールのみを使用してください。

必要条件

- 装置が開いた状態であること(「装置を開く (ページ 59)」の重要な情報を参照してください)。

手順 - 取り外し

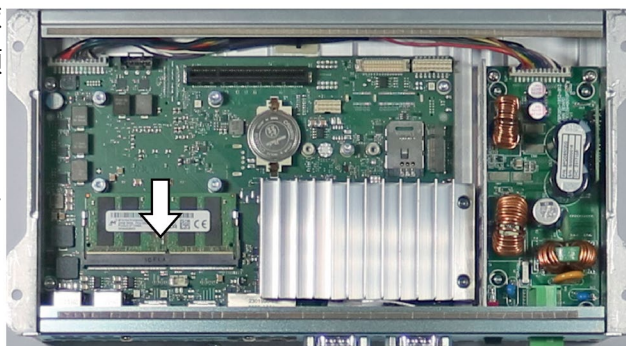
1. モジュールクリップを外側に押し下げます。
メモリモジュールが前方に傾きます。
2. メモリモジュールをスロットから取り出します。



6.3 メモリモジュール

手順 - 設置

1. メモリモジュールをマザーボードを向いている接点側に傾けながら、マークされているスロットに挿入します。
2. ラッチがかみ合うまで、メモリモジュールを慎重に接点ストリップに押し込みます。



挿入および取り外し後

装置を閉めます。

新しいメモリ容量は、自動的に検出され、装置の電源を入れたときに、BIOS Setup に表示されます。

6.4 ドライブ

6.4.1 M.2 NVMe SSD の交換

通知
ドライブの損傷およびデータ損失のリスク ドライブにデータを書き込んでいるときにドライブを取り外すと、ドライブを損傷し、データを破壊することがあります。 <ul style="list-style-type: none">ESD ガイドラインを順守します。

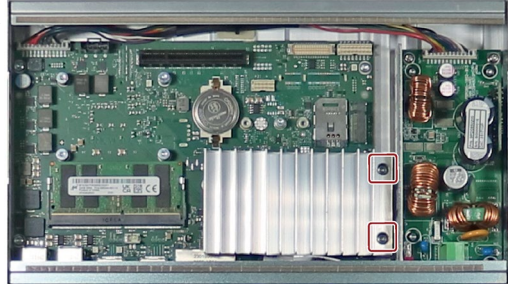
必要条件

- 装置が開いた状態であること。これに関する重要な情報については、「装置を開く (ページ 59)」を参照してください。
- 最大 30 または 80 mm の長さの M.2 NVMe SSD
- 装置がライン電圧から完全に接続解除されていること。「装置をオフにする (ページ 55)」を参照してください。
- Torx T10 型および T8 型ネジまわし

6.4 ドライブ

手順 - 取り外し

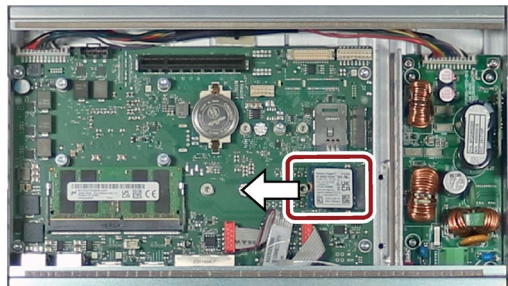
3. Torx T10 型のスクリュードライバを使用して、ヒートシンクの指定されたネジを外します。
2. ヒートシンクを上方に取り外し、横に置きます。



3. Torx T8 型のネジまわしを使用して、マザーボードの指定されたネジを外します。



4. M.2 NVMe SSD をスロットから引き抜きます。



手順 - 設置

取り外し手順を逆順に実施します。

下記も参照

ハードウェアアクセサリ (ページ 17)

装置の保守と修理

7.1 修理に関する情報



警告

未許可で開いて、不適切な修理や拡張を行うことによるリスク

拡張するときに不適切な手順で行うと、装置を破損したりユーザーを危険にさらす恐れがあります。

システム拡張を取り付けたり交換したりして装置を破損した場合は、保証が無効になります。

- この理由で、「装置およびシステム拡張に関する注意事項 (ページ 30)」の情報を順守してください。

7.2 保守間隔

システムの可用性を高く保つには、摩耗する PC 構成部品を予防的に交換することをお勧めします。この交換の間隔は、以下の表のとおりです。

構成部品	交換間隔
バックアップバッテリー	5 年
SSD	使用のタイプによって異なる ¹

¹ フラッシュドライブ(SSD)の交換の間隔は、使用するタイプによって大きく異なります。特定の間隔を指定することはできません。

7.3 装置前面のクリーニング

装置は、メンテナンス操作の負担が少なく設計されています。それでも、装置の前面を定期的にクリーニングする必要はあります。

注意

装置をクリーニングする際に不要な応答

装置のスイッチがオンになっているときに装置をクリーニングすると、制御エレメントが知らずに動作するおそれがあります。

この場合、人身傷害や機械の損傷を引き起こす可能性のある装置またはコントローラの不要な動作が生じるおそれがあります。

- 装置をクリーニングする際は、必ずスイッチをオフにします。

クリーニング剤

通知

許可されていないクリーニング剤による HMI 装置への損傷

許可されていない不適切なクリーニング剤を使用すると、HMI 装置に損傷が生じるおそれがあります。

装置のクリーニングには、湿らせた布のみを使用してください。

- 「周辺条件および環境条件に関する注意事項 (ページ 24)」にある注意事項を参照してください。

装置前面のクリーニング

1. 装置の電源を切ります。
2. クリーニング用布を湿らせます。
3. クリーニング用布で装置をきれいにします。

7.4 ハードウェアの取り外しと設置

7.4.1 バックアップバッテリーの交換



警告

破裂して有毒物質を放出する恐れがあります

間違ったタイプの電池を取り付けると、爆発や火災を引き起こす危険があります。

リチウム電池の不適切な取り扱いは、電池の爆発の原因になる可能性があります。

電池の爆発および汚染物質の放出は、深刻な怪我の原因になる可能性があります。劣化した電池は、装置の機能を危険にさらします。

リチウム電池を扱う場合は、以下のことに注意してください。

- バッテリーは5年毎に交換します。
- リチウム電池は、製造元によって推奨されているタイプの電池とのみ交換してください。新しいリチウム電池がULによって認証され、次の要件を満たしていること。
 - タイプ:CR2450W または BR2450A
 - 定格電圧:3 V DC
 - 最大特殊充電電流:5 mA
- 製品保守に適用される要件を確認するには、技術サポートにお問い合わせください。
- リチウム電池を火に投げ込まないでください。電池筐体へのハンダ付け、電池の分解、短絡、逆極性、100℃以上の加熱を行わないでください。直射日光、湿気、結露から確実に保護してください。



警告

Risque d'explosion et d'émission de substances nocives

l'installation d'une pile ou d'un accumulateur de type inadéquat peut provoquer un DANGER d'explosion ou d'incendie.

Une manipulation non conforme des piles au lithium peut conduire à leur explosion.

L'explosion des piles et l'émission de polluants qui en résulte peuvent entraîner de graves lésions corporelles. Des piles usagées constituent un danger pour le fonctionnement de l'appareil.

Observez les remarques suivantes lorsque vous manipulez des piles au lithium :

- Remplacez la pile tous les 5 ans.
- Remplacez la pile au lithium uniquement par une pile du type recommandé par le constructeur. La nouvelle pile au lithium doit avoir une certification UL et satisfaire aux exigences suivantes :
 - Type : CR2450W ou BR2450A
 - Tension nominale : 3 V CC
 - Courant de charge anormal max. : 5 mA
- Pour toute demande concernant la maintenance du produit, contactez le support technique Siemens.
- Ne jetez pas au feu des piles au lithium, n'effectuez pas de soudage sur la pile, ne la rechargez pas, ne l'ouvrez pas, ne la court-circuitez pas, n'intervertissez pas les pôles, ne la chauffez pas à plus de 100 °C et protégez-la de l'ensoleillement direct, de l'humidité et de la condensation.

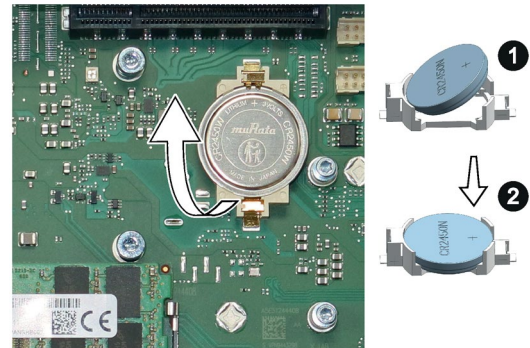
必要条件

- 同一タイプのバックアップバッテリーである純正スペア部品を用意していること。
- 電池を交換するときに、装置の設定データとしての現在のファームウェア/BIOS 設定が削除されることを認識していること。

これに関する情報は、詳細なファームウェア/BIOS 説明で参照できます。装置を操作するための重要な指示およびマニュアル (ページ 9)を参照してください。
- 装置が開いた状態であること。これに関する重要な情報については、「装置を開く (ページ 59)」を参照してください。
- 使用済みバッテリーに関連する地域の規制を順守していること。

手順

1. 図示されているように、ソケットからバッテリーを取り外します。
2. 新しいバッテリーを2つの接点(1)の下に配置し、軽く押しながらベース(2)に押し込みます。
3. 装置を閉めます。
4. ファームウェア/BIOS 設定を確認します。



下記も参照

保守間隔 (ページ 69)

7.5 オペレーティングシステム、ソフトウェアおよびドライバのインストール

ターゲットシステム(つまり、ボリュームのパーティション、インストールされているデバイスドライバのあるオペレーティングシステム、SIEMENS ソフトウェア製品)の工場出荷時の設定に復元できます。これにより、損傷を受けた場合に、デバイスをすばやく復元できます。

オペレーティングシステム、ソフトウェアおよびドライバのプロビジョニング

復元またはドキュメントとドライバセットの可能なソース:

- 付属された USB フラッシュドライブ(オプション、注文した場合)
- Online Software Delivery Portal: Online Software Delivery Portal からデバイスのためのリストアやマニュアルおよびドライバセットをダウンロードできます。これを行うには、Online Software Delivery Portal (<https://www.automation.siemens.com/swdl/register/ipc>)にログインし、必要なデータセットをダウンロードして、それを使用して起動可能な USB フラッシュドライブを作成します。

詳細については、起動可能な USB フラッシュドライブを作成するための製品情報を参照してください(装置を操作するための重要な指示およびマニュアル (ページ 9)を参照)。

オペレーティングシステムのインストール

デバイスと共に注文したオペレーティングシステムのリストアや再インストールの追加情報は、オペレーティングシステムの詳細説明で確認できます。「装置を操作するための重要な指示およびマニュアル (ページ 9)」を参照してください。

ソフトウェアおよびドライバの設置

1. ブート可能な USB フラッシュドライブをデバイスに挿入します。
2. 「START_DoucAndDrivers.CMD」ファイルを実行して、USB フラッシュドライブから「マニュアルおよびドライバ」スイートを起動します。
3. 希望するソフトウェアおよびドライバをインストールします。

7.6 ファームウェア/BIOS の設定

ファームウェア/BIOS の設定に関する情報および引渡し状態のファームウェア/BIOS 設定に関する情報は、「ファームウェア/BIOS 説明」で確認できます。「装置を操作するための重要な指示およびマニュアル (ページ 9)」を参照してください。

注記

お使いの IPC が起動に失敗した場合(例えば、BIOS 更新中のクラッシュなど)、お近く SIEMENS 担当者にお問い合わせください。

「BIOS リカバリ」および「ME 更新」についての情報は、「内部インターフェースのピン割り付け (ページ 99)」を参照してください。

7.7 データバックアップおよびパーティション変更

Windows®でデータをバックアップするには、「SIMATIC IPC Image & Partition Creator」ソフトウェアを推奨しています。「装置を操作するための重要な指示およびマニュアル (ページ 9)」を参照してください。

7.8 リサイクルと廃棄処分

汚染が低レベルに抑制されていることにより、これらの操作説明書で説明する装置はリサイクルできます。環境的に許容される旧型機のリサイクルや処分については、承認された電子機器スクラップ廃棄物処理センタにお問い合わせください。装置の廃棄はお客様の国の関連規則に従って行ってください。

技術仕様

8.1 技術仕様の適用可能性

注記

次の技術仕様は、次の条件下でのみ適用されます。

- 装置が正常に運転できる状態になっていること。
- 装置が閉じた状態であること。
- I/O デバイスは、アプリケーションの該当領域の要件に適合しています (EN 61000-6-3 / IEC 61000-6-3 に準拠した妨害電波放射、EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 に準拠した高周波放射)。

8.2 一般的な技術仕様

「技術仕様の有効性 (ページ 76)」にある注意事項を参照してください。

商品コード	6AV7272-.....-.....(詳細については、注文文書を参照してください)			
外形寸法(W x H x D) mm	12"	15"	19"	22"
	320 x 226 x 89	406 x 258 x t96	473 x 297 x 96	540 x 334 x 96
重量	12"	15"	19"	22"
	約 4.5 kg	約 6 kg	約 7 kg	約 8 kg
電源電圧 DC	公称 12/24 V DC、9-36 V DC			
入力電流 DC	連続電流最大 10 A			
Namur により、短期的な電圧障害	最大 20 ms (12 V 時) 最大 20 ms (20.4 V 時) (最大 10 イベント/時間、リカバリ時間最低 1 秒)			
最大電力消費	83 W (9 V で) 82 W (12 V で) 80 W (24 V で) 77 W (36 V で)			

商品コード	6AV7272-.....-.....(詳細については、注文文書を参照してください)
ノイズエミッション	< 40 dB(A)、DIN 45635-1 に準拠
保護等級	IEC 60529 ¹ に準拠した IP 20 IP 65 (前面)
品質保証	ISO 9001 に準拠
安全性	
保護クラス	IEC 61140 に準拠した保護クラス
汚染レベル	装置は、公害レベル 2 の環境に適合して設計されています。
過渡過電圧	装置は、過電圧カテゴリ II (最大 2500 V の過渡過電圧) の電源に接続するよう設計されています。
安全仕様	<ul style="list-style-type: none"> • IEC 61010-2-201 • EN 61010-2-201 • DIN EN 61010-2-201 • UL 61010-2-201 • CSA C22.2 No 61010-2-201

¹ UL による評価はされていません

下記も参照

9 -36 V DC 電源の接続 (ページ 48)

8.3 電流/電力要件および電源

8.3.1 システムコンポーネントの電流および電力要件

最大電流値

構成部品	電圧		
	+3.3 V	+5 V	+12 V
USB ポート ^{1, 4}	-	0.9 A	-
DisplayPort	1 A	-	-
M.2 NVMe SSD	3.3 A	-	-
M.2 スロット ^{2, 4}	2 A	-	-
PCIe スロット ^{3, 4}	1.5 A	-	0.5 A

- 1 すべての USB 装置の最大合計電力は 18 W です。
- 2 各 M.2 スロットの合計電力は、2.5 W を超過してはなりません。
- 3 各 PCIe スロットの合計電力は、8 W を超過してはなりません。
- 4 すべての USB ポート、M.2 および PCIe スロットの合計電力は、15 W を超過してはなりません。

公称電力値

構成部品	消費電流 12 V DC	電力消費 効率 0.85	消費電流 24 V DC	電力消費 効率 0.85
BIOS 設定[電源およびパフォーマンスシナリオ] = [高温]または[安定パフォーマンス]を使用する装置	3.30 A	39.60 W	1.65 A	39.60 W
BIOS 設定[電源およびパフォーマンスシナリオ] = [バランス]を使用する装置	3.88 A	46.56 W	1.93 A	46.32 W
BIOS 設定[電源およびパフォーマンスシナリオ] = [最高パフォーマンス]を使用する装置	4.20 A	50.40 W	2.14 A	51.36 W

8.3.2 技術仕様: DC 電源(DC)

保護等級	IP20 (取り付け状態時)
保護クラス	VDE 0106

電源の特性	DC 電源
入力データ	
電圧	公称 12/24 V DC、9-36 V DC (電氣的に絶縁されていない)
直流	最大 10.6 A
スタート電流(負荷に依存)	最大 40 A (1.6 ms の間) 最大 25 A (さらに 4 ms)
• I ² t 値:	最大 4.5 A ² s
有効電力	96 W

8.4 Electromagnetic compatibility (電磁環境両立性)

電源の特性	DC 電源
出力データ	
電圧	+12 V / 7.1 A
電力出力	
• 常時電力	最大 85 W
• 臨時電力(30 秒)	最大 140 W
• ピーク電力(10 ms)	最大 210 W

8.4 Electromagnetic compatibility (電磁環境両立性)

「技術仕様の適用可能性 (ページ 76)」にある注意事項を参照してください。

妨害電波放射	EN 61000-6-3、EN 61000-6-4、CAN/CSA CISPR32 クラス B、KS C 9610-6-3、FCC クラス A
耐干渉性	EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、KS C 9610-6-2
電源ケーブルの耐干渉性	± 2 kV (IEC 61000-4-4 に準拠、バースト) ± 1 kV (IEC 61000-4-5 に準拠、対称サージ) ± 2 kV (IEC 61000-4-5 に準拠、非対称サージ)
信号線の耐ノイズ性	± 1 kV、IEC 61000-4-4 に準拠、バースト、長さ < 30 m ± 2 kV、IEC 61000-4-4 に準拠、バースト、長さ > 30 m ± 2 kV、IEC 61000-4-5 に準拠、サージ、長さ > 30 m
静電放電に対する耐性	± 6 kV 接触放電(IEC 61000-4-2 に準拠) ± 8 kV 空中放電(IEC 61000-4-2 に準拠)
無線外乱に対する耐性	<ul style="list-style-type: none"> • 10 V/m、80 MHz ~ 2.7 GHz、 80% AM (IEC 61000-4-3 に準拠) • 3 V/m、2.7 ~ 6 GHz、 80% AM (IEC 61000-4-3 に準拠) • 10 V、10 KHz ~ 80 MHz、 80% AM (IEC 61000-4-6 に準拠)

8.5 周辺環境

「技術仕様の適用可能性 (ページ 76)」にある注意事項を参照してください。

周囲の気候条件	
温度 - 動作時	水平フォーマット - 横: • 0 ~ +50 °C ¹ 水平フォーマット - 傾きは最大± 45°: • 0 ~ +50 °C ¹ 垂直フォーマット - 縦: • 0 ~ +45 °C ¹
- 保管/運搬時	-20 ~ +60 °C
- 変化率	動作時最高 10 °C/h、保管時 20 °C/h、結露なし
相対湿度 - 動作時	IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-30 に従って試験済み 温度 0 °C ~ 30 °C、相対湿度 5 ~ 85% 許容範囲: 0 ~ 31 °C: 5 ~ 80%、55 °C 時に線形的に 5 ~ 25% で低下
- 保管/運搬時	温度 25 °C ~ 55 °C、相対湿度 95%
大気圧 - 動作時	1080 ~ 689 hPa (-1000 ~ 2000 m の海拔高度に相当)
- 保管/運搬時	1080 ~ 660 hPa (-1000 ~ 3500 m の海拔高度に相当)
機械的周囲条件	
振動 - 操作時 - 保管/運搬時	DIN IEC 60068-2-6 に従って試験済み 5 ~ 9 Hz: 3.5 mm、9 ~ 500 Hz: 9.8 m/s ² 5 ~ 9 Hz: 3.5 mm、9 ~ 500 Hz: 9.8 m/s ²
耐衝撃性 - 動作時 - 保管/輸送時	IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-29 に従って試験済み 半正弦波 150 m/s ² 、11 ms、 半正弦波 250 m/s ² 、6 ms

¹ この情報は、BIOS Setup の[バランス]設定に適用されます([詳細]メニュー > [電源およびパフォーマンス] > [CPU 電源管理コントロール] > [電源およびパフォーマンス シナリオ])。最高周囲温度は、[最大パフォーマンス]設定の場合には 5 °C 低くする必要があります。

8.6 ドライブの技術仕様

「技術仕様の適用可能性 (ページ 76)」にある注意事項を参照してください。

SSD	M.2 NVMe SSD >= 256 GB、形状係数 22 mm x 30 mm または 22 mm x 80 mm、タイプ M
-----	--

8.7 マザーボードの技術仕様

「技術仕様の適用可能性 (ページ 76)」にある注意事項を参照してください。

チップセット	Intel® RM590E
プロセッサ	<ul style="list-style-type: none"> • Intel® Celeron® 6600HLE 2 コア/2 スレッド、2.1 GHz、8 MB キャッシュ • Intel® Xeon® W-11155MLE 4 コア/8 スレッド、1.8 (3.1) GHz、8 MB キャッシュ • Intel® Xeon® W-11555MLE 6 コア/12 スレッド、1.9 (4.4) GHz、12 MB キャッシュ、vPro (iAMT) • Intel® Xeon® W-11865MLE 8 コア/16 スレッド、1.5 (4.5) GHz、24 MB キャッシュ、vPro (iAMT)
メインメモリ	4 最大 32 GB、DDR4 SDRAM、SODIMM 機能については、注文文書を参照してください

8.8 グラフィック/ディスプレイの技術仕様

「技術仕様の適用可能性 (ページ 76)」にある注意事項を参照してください。

グラフィックコントローラ

グラフィックコントローラ	Intel® UHD Graphics 16 EU: <ul style="list-style-type: none"> • Intel® Celeron® 6600HLE • Intel® Xeon® W-11155MLE Intel® UHD Graphics 32 EU: <ul style="list-style-type: none"> • Intel® Xeon® W-11555MLE • Intel® Xeon® W-11865MLE
解像度/周波数/色	DisplayPort:最大 4096 × 2304 / 60 Hz / 36 ビット

ディスプレイ

	12"	15"	19"	22"
ディスプレイタイプ	LCD TFT	LCD TFT	LCD TFT	LCD TFT
有効表示エリア	261 x 163 mm	344 x 194 mm	410 x 230 mm	476 x 268 mm
解像度	1280 x 800 ピクセル	1366 x 768 ピクセル	1366 x 768 ピクセル	1920 x 1080 ピクセル
表示可能な色	最高 1670 万			
バックライト半輝度寿命 (MTBF ¹)	LCD 50000 時間	LCD 50000 時間	LCD 30000 時間	LCD 30000 時間
ISO 9241-307 に準拠したピクセルエラークラス	III			
電力消費	6 W	11 W	13 W	11 W

¹ MTBF:最大輝度が元の値の半分に減少するまでの動作時間。たとえばスクリーンセイバーによる時間コントロールや PROFlenergy による集中管理などの統合的調光機能を使用すると MTBF は長くなります。

8.9 インターフェースの技術仕様

「技術仕様の適用可能性 (ページ 76)」の情報を順守し、純正の I/O 接続のみを使用してください。

DisplayPort ¹	2 x DisplayPort モニタの接続
キーボード	USB サポート
マウス	USB サポート
USB	4 x USB 3.2 Gen 2 タイプ A、高電流、下位互換性あり
Ethernet ²	<p>2 x Ethernet インターフェース (RJ45)、10/100/1000 Mbps</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Ethernet 1: Intel® Jacksonville i219-LM、iAMT 互換 ^{3、4} • 1 x Ethernet 2: Intel® Springville i210-IT <p>Wake on LAN、リモート起動および次のチーミングモードがサポートされています ⁵:</p> <ul style="list-style-type: none"> • アダプタフォールトトレランス (AFT) • アダプティブロードバランシング (ALB) • IEEE 802.3 およびダイナミックリンクアグリゲーション (DLA) • スタティックリンクアグリゲーション (SLA) • スイッチフォールトトレランス (SFT)
COM1、COM2	RS232/RS422/RS485、最大 115 kbps、9 ピン D-sub、オス
COM3、COM4 (オプション)	RS232、最大 115 kbps、9 ピン D-sub、オス

- ¹ アナログモニタは、アダプタケーブル(オプション)と一緒に使用できます。
- ² 一義的に表記するために、Ethernet インターフェースの筐体に番号が付いています。オペレーティングシステムによる番号は異なる場合があります。
- ³ iAMT とのチーミングなし。
- ⁴ iAMT を使用する場合は、インターフェース X1 P1 はリモート保守に接続するために使用する必要があります。
- ⁵ ポート X1 P1 および X2 P1 を使用する場合のみ可能。

8.10 オペレーティングシステムの技術仕様

注文した装置設定に基づいて、装置は、次のインストール済みオペレーティングシステムのいずれかがありまたはなしで装備されます。

- Microsoft® Windows® 10 Enterprise 2021 LTSC、64 ビット、多言語*

* マルチ言語ユーザーインターフェース(MUI):5 言語(英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語)

注文した Microsoft® Windows® オペレーティングシステムに関する情報は次で参照できます。

装置を操作するための重要な指示およびマニュアル (ページ 9)

引渡し状態のブートモードおよびパーティション

Windows® 10 の引渡し状態

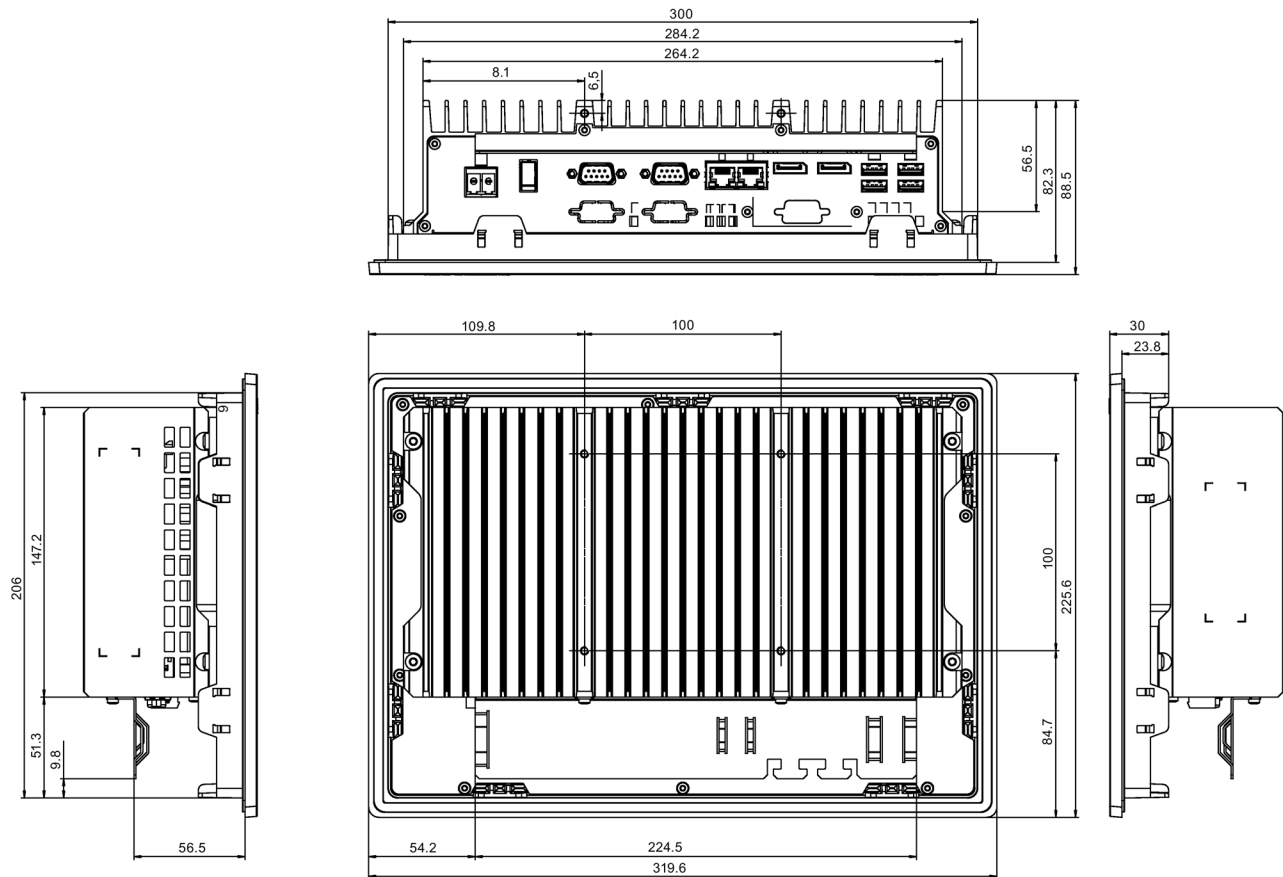
Windows® 10 は、引渡し状態では、UEFI モードで起動されます。

次の表は、GPT モードの、200 GB 以上のディスクのパーティションを一覧表示しています。

パーティション	名称	サイズ	ファイルシステム
第 1	Boot	260 MB	FAT32
第 2	MSR	128 MB	なし
第 3	System	160 GB	NTFS
第 4	WinRE	500 MB	NTFS
第 5	Data	残り	NTFS

寸法図

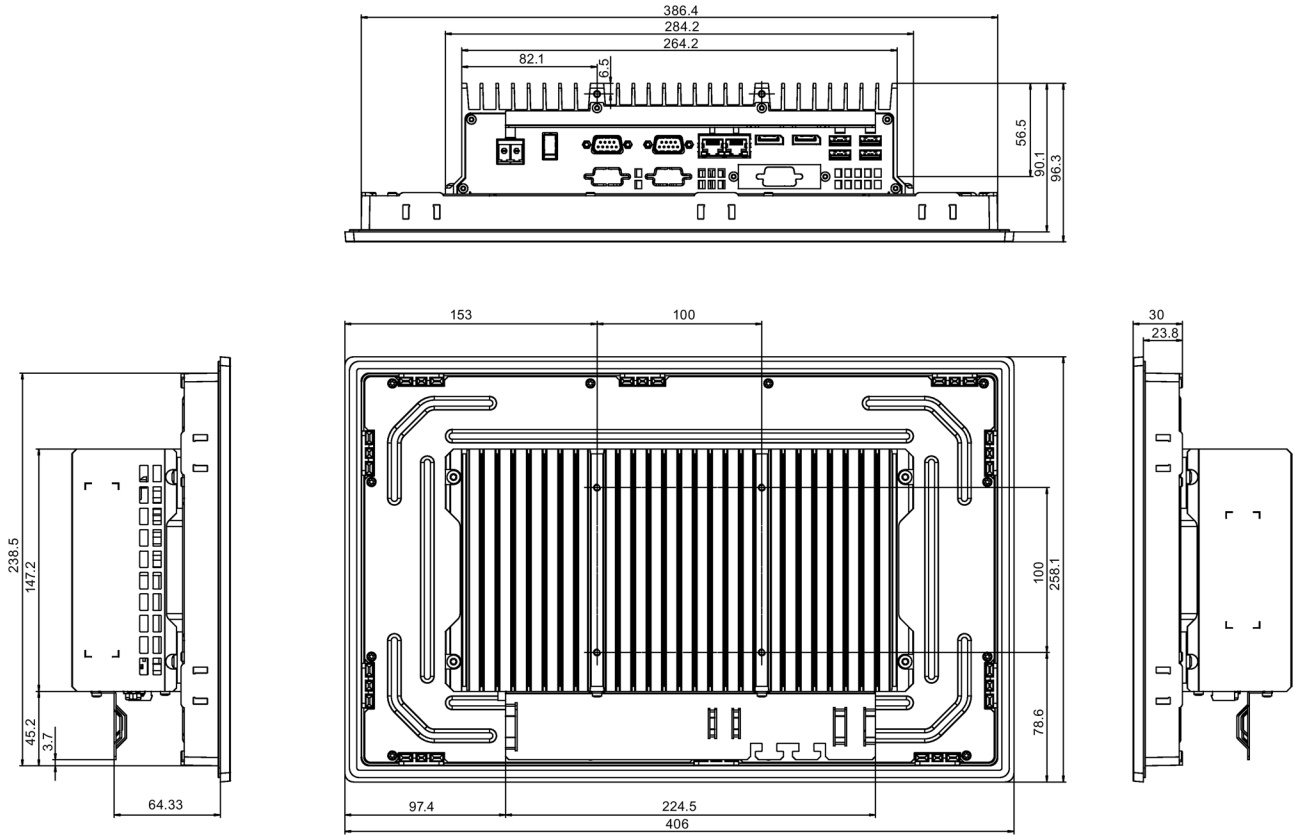
9.1 抵抗性シングルタッチスクリーン搭載 12"装置の寸法図



すべての寸法はmm単位です

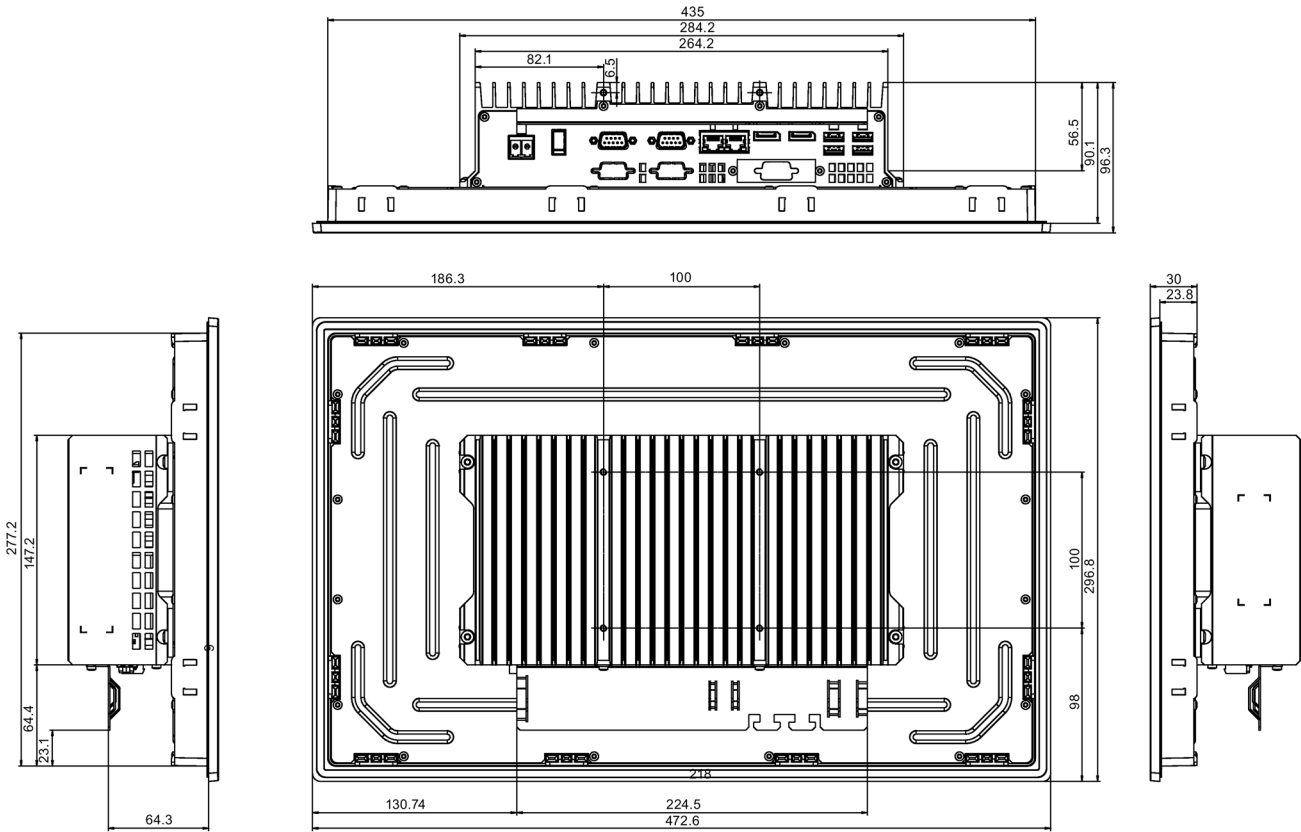
9.2 抵抗性シングルタッチスクリーン搭載 15"装置の寸法図

9.2 抵抗性シングルタッチスクリーン搭載 15"装置の寸法図



すべての寸法はmm単位です

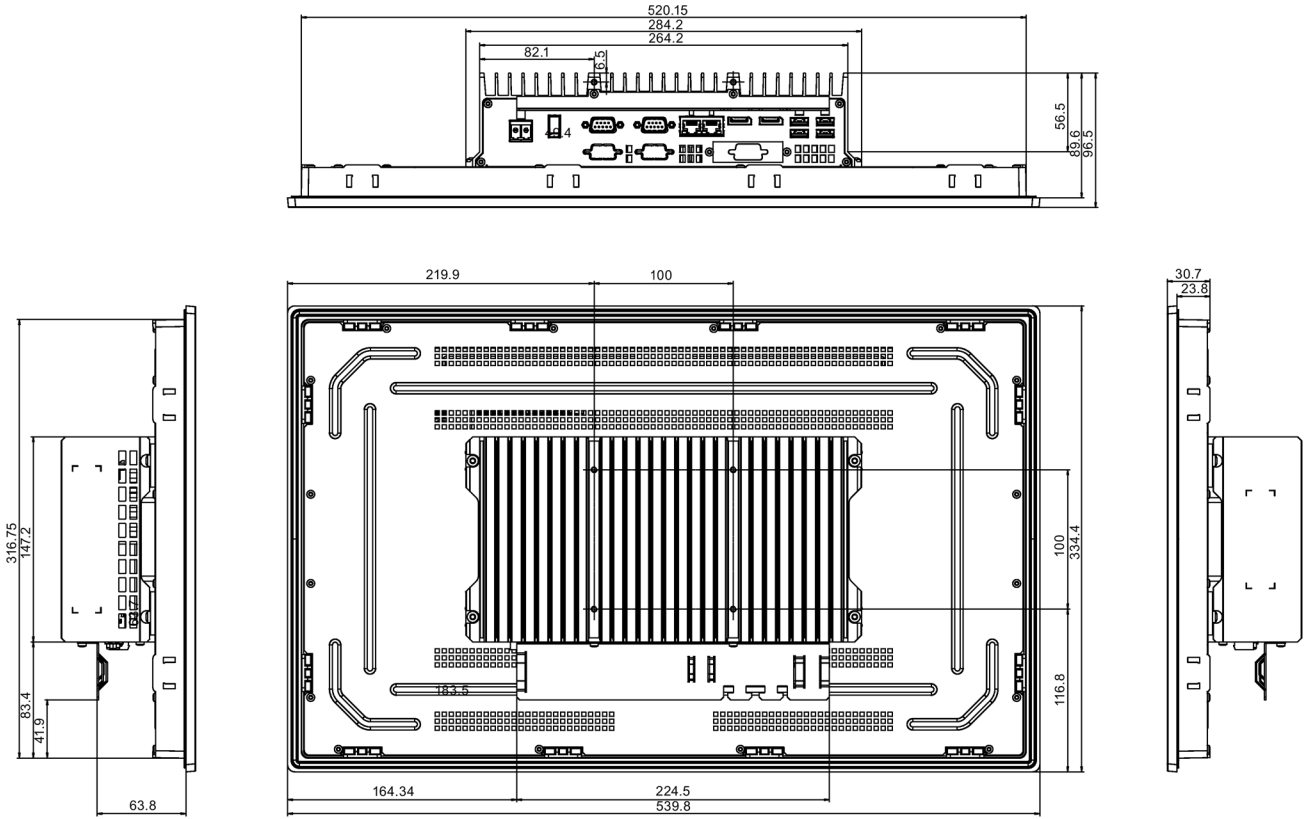
9.3 抵抗性シングルタッチスクリーン搭載 19"装置の寸法図



すべての寸法はmm単位です

9.4 抵抗性シングルタッチスクリーン搭載 22"装置の寸法図

9.4 抵抗性シングルタッチスクリーン搭載 22"装置の寸法図

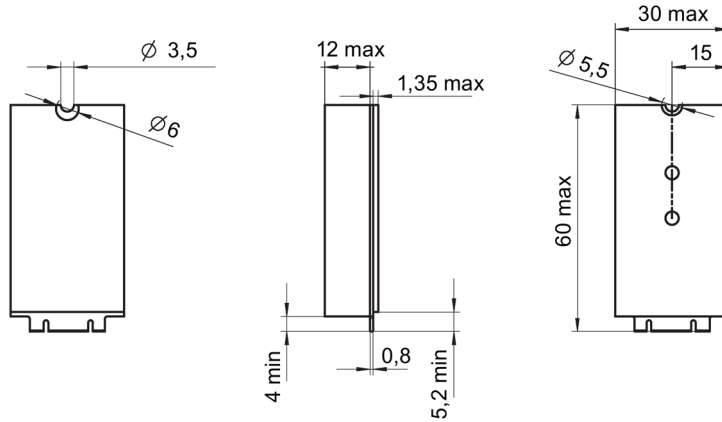


すべての寸法はmm単位です

9.5 拡張モジュールの寸法図(M.2)

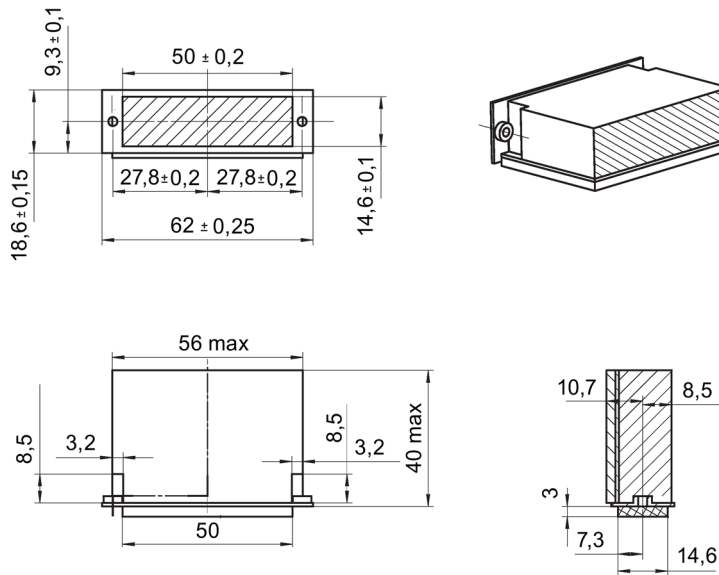
9.5 拡張モジュールの寸法図(M.2)

拡張モジュールの最大寸法



Alle Angaben in mm

コンディショナカードの寸法図



Alle Angaben in mm

規格と承認

10.1 適用範囲

注記

適用範囲

可能な承認については、後述を参照してください。ご使用の装置に適用される承認は、銘板に記載されています。

10.2 CE マーキング



デバイスは、以下の指令の一般必要条件と安全関連の必要条件に対応しています。また、オートメーションシステムは、欧州連合の公報で公開された統一欧州標準(EN)にも準拠しています。

- 2014/30/EU「電磁環境両立性指令」(EMC 指令)

装置は、CE マークに対応する次の適用分野向けに設計されています。

適用範囲	要件	
	妨害電波放射	耐干渉性
工業用	EN 61000-6-4	EN 61000-6-2
住宅、商業、軽工業地域	EN 61000-6-3	EN 61000-6-1

- 2011/65/EU「電気電子機器中の特定有害物質の使用の制限」(RoHS 指令)

EU 適合性宣言

関連する適合性宣言は、インターネット上の次のアドレスを参照してください。パネル PC 認証 (<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10805572/134200>)

10.3 UKCA マーキング



本装置は、英国政府の公式な統合リストで公開された電気機器向けに指定された英国規格(BS)に準拠しています。この装置は、次の規制および関連する修正項の要件および保護対象に適合しています。

- 電磁環境適合性規制 2016 (EMC)
- 電気機器および電子機器中の特定有害物質の使用の制限 2012 (RoHS)

UKCA 適合性宣言

関連する適合性宣言は、インターネット上の次のアドレスを参照してください。

- パネル PC 認証
(<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10805572/134200>)

10.4 DIN ISO9001 認証とソフトウェアライセンス契約

ISO 9001 認証

全体的な製品作成システム(開発、製造、販売)のための Siemens 社品質管理システムは、ISO 9001 の要件を満たしています。

これは DQS (ドイツ品質保証機構)により認定されています。

ソフトウェア使用許諾契約

装置にソフトウェアが事前インストール済みで供給されている場合、対応するライセンス契約に従わなければなりません。

10.5 UL 認可



装置には次の認可を取得できます。

- Underwriters Laboratories (UL)。規格 UL 61010-1 および UL 61010-2-201、ファイル E472609 に準拠
- カナダ国家規格 CAN/CSA No. 61010-1-12 および CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201

10.6 FCC (USA)

米国	
Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement	This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.
Shielded Cables	Shielded cables must be used with this equipment to maintain compliance with FCC regulations.
Modifications	Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.
Conditions of Operations	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

供給者適合宣言の責任者

Siemens Industry, Inc.

Digital Factory - Factory Automation

5300 Triangle Parkway, Suite 100

Norcross, GA 30092

米国

mailto:amps.automation@siemens.com ([mailto: amps.automation@siemens.com](mailto:amps.automation@siemens.com))

10.7 カナダ

カナダ	
カナダの注意事項	This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Avis Canadien	Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

10.8 オーストラリア/ニュージーランド

オーストラリア/ニュージーランド



この製品は標準 EN 61000-6-3 『一般規格 – 工業地域の環境に対する排出基準』の要件を満たしています。

This product meets the requirements of the standard EN 61000-6-3 Generic standards - Emission standard for industrial environments.

10.9 ユーラシア関税同盟 EAC

ユーラシア関税同盟の識別情報



- EAC (Eurasian Conformity)
- 関税同盟の技術規則(TR CU)に準拠する適合性宣言

10.10 韓国

韓国



この製品は、韓国認定の要件に適合しています。

This product satisfies the requirement of the Korean Certification (KC Mark).

이 기기는 업무용(A 급) 전자파 적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.


10.11

台湾



This product meets the requirements of CNS15936, CNS15598-1 generic standard.

この製品は、CNS 15936、CNS 15598-1 の一般規格の要件を満たしています。

 警告
警告 為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境。

限用物質含有情況標示聲明

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium(Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
硬碟	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○

備考 1. "超出 0.1 wt %"及"超出 0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1 : "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2 : "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. "-"係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

電池和蓄電池



警告

- 置換可能影響安全防護的錯誤型式的電池（例：在某些鋰電池類型的情形下）；
- 電池丟入火焰或烤箱中，或將電池作可能導致爆炸的機械擠壓或切割；
- 電池置於可能導致爆炸或可燃性液體或氣體洩漏的高溫環境中；且
- 電池承受可能導致爆炸或可燃性液體或氣體洩漏的極度低氣壓。

Responsible party for Supplier's Declaration of Conformity / 供應商符合性聲明的責任方

西門子股份有限公司

臺北市 11503 南港區園區街 3 號 8 樓

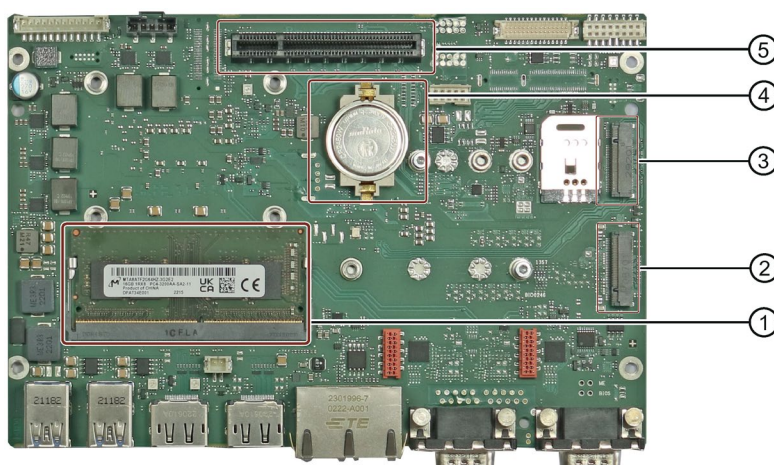
電子郵件信箱：Adscs.taiwan@siemens.com

ハードウェアの説明

A.1 マザーボード

A.1.1 マザーボードのレイアウト

マザーボードは、これらの主なコンポーネントで構成されています。プロセッサおよびチップセット、メモリモジュール用の1つのスロット、内部および外部インターフェース、BIOS用のフラッシュブロック。



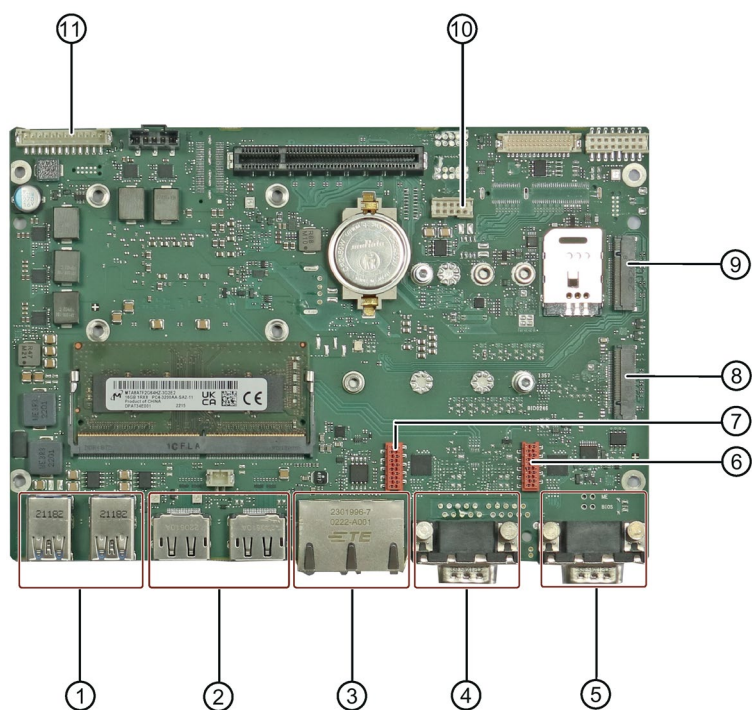
- ① メモリモジュール用スロット
- ② M.2 NVMe SSD 用スロット
- ③ 拡張モジュールのスロット(M.2)
- ④ バックアップバッテリー
- ⑤ バスボード用スロット

マザーボードの技術的な特徴

マザーボードの技術的な特徴は、「マザーボードの技術仕様 (ページ 82)」で参照できます。

A.1 マザーボード

A.1.2 マザーボードのインターフェース位置



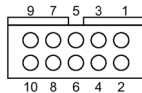
- | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|
| (1) 4 x USB
(X60/X61/X62/X63) | (5) COM2 (X31) | (9) M.2 PCIe インターフェース(X100) |
| (2) 2 x DPP (X70/X71) | (6) COM4 (X33) | (10) USB 2.0 (X64 内部 1) |
| (3) 2 x Ethernet
(X1 P1 iAMT 互換/X2 P1) | (7) COM3 (X32) | (11) 電源(X10) |
| (4) COM1 (X30) | (8) M.2 NVMe SSD 用インターフェース(X101) | |

A.2 内部インターフェース

A.2.1 内部インターフェースのピン割り付け

インターフェース	位置	説明
メモリ	内部	1 SODIMM ソケット、64 ビット
バスボード	内部	バスボード用ソケット、PCIe バス信号が割り当て
電源	内部	電源用 12 ピン接続プラグ
バックアップバッテリー	内部	バックアップバッテリー用電源、2 ピンソケット
USB ポート	内部	USB チャンネル、10 ピンオスコネクタ
M.2 インターフェース	内部	M.2 キーB、PCIe バス信号が割り当て
SSD ドライブベイのポート	内部	SSD ドライブベイ用ソケット、PCIe バス信号が割り当て

A.2.2 USB ポート



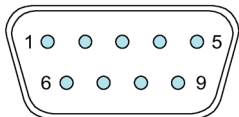
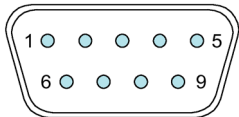
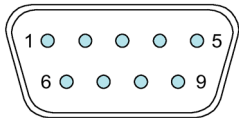
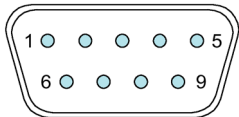
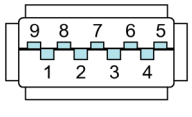
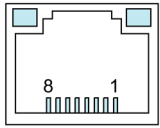
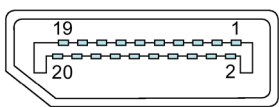
ピン	名称
1	VBUS_USB1
2	VBUS_USB2
3	USB1_D-
4	USB2_D-
5	USB1_D+
6	USB2_D+
7	GND
8	GND
9	GND
10	GND

A.3 外部インターフェース

注記

インターフェース仕様

下記に一覧表示されているすべての外部インターフェースのデータは、対応するインターフェース仕様および使用目的に対応しています。

インターフェース	コネクタ	説明	割り付け
COM1	X30	9 ピン D-sub コネクタ	
COM2	X31	9 ピン D-sub コネクタ	
COM3	X32	9 ピン D-sub コネクタ	
COM4	X33	9 ピン D-sub コネクタ	
USB 3.2	X60、 X61 X62、 X63	USB 3.2 Gen 2 ソケットタイプ A	
Ethernet 1、 2、3 および 4	X1 P1、 X2 P1、 X3 P1、 X4 P1	RJ45	
DPP	X70、 X71	20 ピン DisplayPort コネクタ	

A.4 システムリソース

A.4.1 現在割り当てられているシステムリソース

すべてのシステムリソース(ハードウェアアドレス、メモリ設定、割り込みの割り付け、DMA チャンネル)は、ハードウェアの設定、ドライバおよび接続されている外部機器に応じて、Windows®オペレーティングシステムにより動的に割り付けられています。システムリソースの現在の設定、または Windows®で起こる可能性のある競合を表示できます。

1. 「Windows キー」よ「R」を同時に押します。
[実行]ダイアログボックスが開きます。
2. [開く]フィールドに「msinfo32」と入力します。
3. [OK]をクリックして、入力内容を確定します。

A.4.2 I/O アドレス割り付け

A.4.2.1 内部モジュールレジスタの概要

次のアドレスが内部レジスタに使用されています。

I/O アドレス(16 進数)	入力/出力装置
280 h	ベーシックアドレス
基本アドレス+オフセット 0	GPIO ポートセレクトレジスタ
基本アドレス+オフセット 2	GPIO データレジスタ
基本アドレス+オフセット 5	WDT コントロールレジスタ
基本アドレス+オフセット 6	WDT カウンタレジスタ
基本アドレス+オフセット 7	WDT ステータスレジスタ

以下の表は、装置の工場出荷時のシステムリソースを示しています。

下記も参照

ウォッチドッグタイマー(WDT)レジスタ(読み取り/書き込み)(ページ 103)

A.4.2.2 バッテリステータスレジスタ(書き込み禁止)

CMOS バッテリ(2つのレベル)のステータスは、次のようにバッテリステータスレジスタを介して読み取ることができます。

注記:常に読み取り-修正-書き込み操作を使用し、予約ビットが上書きされないようにしてください。これにより、デバイスの機能が損なわれることがあります。

手順

1. 06h を GPIO ポートセレクトレジスタ(280h)に書き込み、関連のレジスタ(GPIO6)を選択します。
2. バッテリステータスの情報を取得するには、GPIO6 データレジスタ(282h)から希望の値を読み取ります。

ビットの意味

バッテリステータスレジスタ(読み取り、アドレス 282h)								ビットの意味
ビット								
7	6	5	4	3	2	1	0	
							x	予約済み
						x		予約済み
					x			予約済み
			0	0				CMOS バッテリ容量がまだ充分
			0	1				CMOS バッテリ容量は少なくなっています(残り容量は約1ヶ月分)。
			1	1				CMOS バッテリが空か存在しません
		x						予約済み
	x							予約済み
x								予約済み

A.4.2.3 ウォッチドッグタイマー(WDT)レジスタ(読み取り/書き込み)

ウォッチドッグタイマー(WDT)を操作する手順を以下に記述します。

注記:常に読み取り-修正-書き込み操作を使用し、予約ビットが上書きされないようにしてください。これにより、デバイスの機能が損なわれることがあります。

カウントダウン時間を入力し、タイマーを起動

1. WDT カウントモードの希望の値(分か秒)を WDT コントロールレジスタ(285h)に書き込みます。
2. 希望のカウントダウン時間を WDT カウンタレジスタ(286h)に書き込みます。

カウントダウンが開始されます。カウントダウンが 0 に到達すると、WDT の有効期限が切れます。WDT の有効期限が切れると、WDT 状態「有効期限切れ」がリセットされるまで、カウントダウンは再起動されません。

WDT カウントダウンのリセット

1. 最初のカウントダウン時間あるいは新しいカウントダウン時間を WDT カウンタレジスタ(286h)に書き込みます。

WDT がカウントダウンを開始します。カウントダウンが 0 に到達すると、WDT の有効期限が切れます。

WDT の停止

1. WDT を完全に停止するためには、WDT カウンタレジスタに 0 を書き込みます。

WDT の有効期限が切れたときの動作の設定

1. WDT システムリセットの希望の値(オンまたはオフ)を GPIO2 データレジスタ(282h)に書き込みます。
 - オンの場合、WDT の有効期限が切れると、システムが再起動します。WDT 状態が「有効期限切れ」に設定され、「PC ON/WD」LED が赤色に点滅を開始します。
 - オフの場合、WDT の有効期限が切れても、システムが再起動しません。WDT 状態が「有効期限切れ」に設定され、「PC ON/WD」LED が赤色に点滅を開始しません。

WDT 状態の読み取り

1. WDT ステータスレジスタ(287h)から現在の WDT ステータス(アクティブか有効期限切れ)を読み取ります。

WDT 状態「有効期限切れ」のリセット

1. WDT ステータスレジスタ(287h)に 0 を書き込み、WDT を再度「アクティブ」に切り替えます。

この手順は「PC ON/WD」LED をリセットします。赤色の点滅から通常の状態(緑色に点灯)に移行します。

WDT がカウントダウンを開始します。この動作を防止するには、状態を「アクティブ」にリセットする前に WDT を停止します。

ビットの意味

WDT コントロールレジスタ(読み取り/書き込み、アドレス 285h)								ビットの意味
ビット								
7	6	5	4	3	2	1	0	
							x	予約済み
						x		予約済み
					x			予約済み
				0				WDT カウントモード:秒単位
				1				WDT カウントモード:分単位
			x					予約済み
		x						予約済み
	x							予約済み
x								予約済み

WDT カウンタレジスタ(読み取り/書き込み、アドレス 286h)								
ビット								ビットの意味
7	6	5	4	3	2	1	0	
00h-FFh								カウントタイム時間

WDT ステータスレジスタ(読み取り/書き込み、アドレス 287h)								
ビット								ビットの意味
7	6	5	4	3	2	1	0	
							x	予約済み
						x		予約済み
					x			予約済み
				x				予約済み
			0					WDT ステータス:アクティブ
			1					WDT ステータス:期限切れ
		x						予約済み
	x							予約済み
x								予約済み

A.4.2.4 NVRAM アドレスレジスタ

NVRAM は、PCI レジスタを介して読み取ることができる 512 KB のメモリアドレス範囲を占有します。

ビットの意味

NVRAM アドレスレジスタ		
PCI レジスタアドレス NVRAM 基本アドレスレジスタ	PCI レジスタの内容 NVRAM メモリアドレス(デフォルト)	メモリ領域の長さ
E300 0000	アドレスは動的に割り付けられます(装置の設定によって異なる)。	80000 時間

技術サポート

B.1 サービスおよびサポート

製品に関する追加情報やサポートはインターネットの次のアドレスにあります：

- 技術サポート (<https://support.industry.siemens.com>)
- サポートリクエストフォーム (<https://www.siemens.com/supportrequest>)
- SIMATIC PC/PG のアフターサービス情報システム (<https://www.siemens.com/asis>)
- SIMATIC マニュアルセット (<https://www.siemens.com/simatic-tech-doku-portal>)
- 最寄りの担当代理店 (https://www.automation.siemens.com/aspa_app)
- トレーニングセンター (<https://siemens.com/sitrain>)
- Industry Mall (<https://mall.industry.siemens.com>)

最寄りの担当代理店またはテクニカルサポートにお問い合わせの際は、以下の技術情報をご用意ください：

- デバイスの商品番号(MLFB)
- 産業用 PC の BIOS のバージョンまたは装置のイメージバージョン
- 他の取り付けられているハードウェア
- 他のインストールされているソフトウェア

ツールとダウンロード

装置にダウンロードして使用可能な更新やホットフィックスがないか、定期的にチェックしてください。ダウンロード領域は、次のリンクでインターネットから利用できます。

アフターサービス情報システム SIMATIC IPC/PG (<https://www.siemens.com/asis>)

B.2 トラブルシューティング

B.2.1 装置の機能の問題

問題	原因	対策
装置が動作していない	装置に電源が入っていません。	<ul style="list-style-type: none"> 電源、電源コード、電源プラグをチェックします。 オン/オフスイッチが正しい位置にあるかをチェックします。
	装置が指定された周囲環境外で動作しています。	<ul style="list-style-type: none"> 周囲環境をチェックします。 寒い気候の輸送後は、装置のスイッチを入れる前に約 12 時間待機させます。
Windows が起動しない	ファームウェア/BIOS の設定が正しくない	<ul style="list-style-type: none"> ファームウェア/BIOS ブートメニューの設定をチェックします。
外部モニタが暗いままである。	モニタのスイッチがオフになっています。	モニタのスイッチを入れます。
	モニタが"パワーセーブ"モードになっています。	キーボードのいずれかのキーを押します。
	輝度ボタンが暗く設定されています。	画面の輝度を上げます。詳細については、モニタの取扱説明書を参照してください。
	電源コードあるいはモニタケーブルが接続されていません。	<ul style="list-style-type: none"> 電源コードがモニタおよびシステムユニットあるいは耐震性のある接地コンセントに正しく接続されているかをチェックします。 モニタケーブルがシステムユニットおよびモニタに正しく接続されているかをチェックします。
		以上のチェックを実行した後でもまだモニタ画面が暗い場合は、技術サポートチームに連絡します。

問題	原因	対策
マウスポインタが画面に表示されない。	マウスドライバがロードされていません。	マウスドライバが正しくインストールされ、ユーザープログラムを開始したときに使用できるかどうかを確認します。マウスドライバについての詳細は各マニュアルを参照してください。
	マウスが接続されていません。	<ul style="list-style-type: none"> マウスコードがシステムユニットに正しく接続されているかを確認します。 アダプタまたはマウスケーブルの延長を使用している場合は、これらのコネクタも確認します。 <p>これらのチェックと対策を実行してもまだカーソルが画面に表示されない場合は、技術サポートチームに連絡します。</p>
PC の時刻および/または日付が間違っています。		<ol style="list-style-type: none"> ファームウェア/BIOS メニューを呼び出します。これを行うには、ブートプロセス中に「<Esc>」ボタンを押し、[セットアップユーティリティ]を選択します。 [メイン]タブで日付および時刻を設定し、変更内容を保存します。
ファームウェア/BIOS の設定を修正した後も、時刻と日付が間違っています。	バックアップバッテリーが切れています。	バックアップバッテリーを交換します。
USB 装置が応答しません。	USB ポートがファームウェア/BIOS で無効化されています。	別の USB ポートを使用するか、ポートを有効にします。
	オペレーティングシステムが USB ポートをサポートしていません。	その他のデバイスには、使用しているオペレーティングシステム用の USB デバイスドライバが必要です。

B.2 トラブルシューティング

B.2.2 装置を起動するときの問題

問題	原因	対策
コンピュータが起動しないか、[Boot device not found]というメッセージが表示されます。	ブートメディアが有効化されていません	ファームウェア/BIOS で、[Boot] > [Boot device]を[Enabled]に設定して、起動優先順位を設定します。
	ブート媒体がファームウェア/BIOS のブート優先度で最優先になっていません	ファームウェア/BIOS の[Boot] > [EFI]で、起動優先順位を変更します。
	ブートデータキャリアが GPT でセットアップされており、UEFI ブートがファームウェア/BIOS で無効にされています	ファームウェア/BIOS で UEFI モードを有効にします。



マークおよびシンボル

C.1 概要

次の表に、取扱説明書で説明されているシンボルに加えて、お使いの SIMATIC 産業用 PC、SIMATIC 産業用モニタまたは SIMATIC Field PG で目にする可能性のあるすべてのシンボルを示します。

お使いの装置のシンボルは、次の表で示されているシンボルと一部の詳細が異なることがあります。

C.2 安全性














シンボル	意味		シンボル	意味
	警告。提供された取扱説明書に順守。			ロックが閉じられています
	注意。無線機器			ロックが開かれています
	開ける前に電源プラグを外してください			Kensington ロックの開口部
	ESD (静電気に敏感な装置)の注意			過熱した表面の警告

C.3 オペレータ制御




















シンボル	意味		シンボル	意味
	オン/オフスイッチ。電氣的絶縁なし			オン/オフスイッチ。電氣的絶縁なし

C.4 認証、承認およびマーク

次の表に、装置に記載されている可能性のある認証、承認およびマークに関連するシンボルを示します。詳細な情報は、お使いの装置の取扱説明書で参照できます。

シンボル	意味		シンボル	意味
	オーストラリアとニュージーランドの承認			ユーラシア関税同盟のマーク
	中国の承認			Factory Mutual Research のテストマーク
	欧州諸国の CE マーキング			米国の連邦通信委員会のマーキング
	中国の EFUP (Environment Friendly Use Period) マーキング			韓国の承認
	UL (Underwriters Laboratories) のテストマーク			英国の UKCA マーク
	インドの承認			廃棄情報、地域の法規を順守。
	台湾の承認			

C.5 インターフェース

シンボル	意味	シンボル	意味
	電源への接続		PS/2 マウスインターフェース
	保護導体端子		PS/2 キーボードインターフェース
	機能接地用接続(等電位ボンディングライン)		マルチメディアカードリーダー
DPP	DisplayPort インターフェース		スマートカードリーダー
	DVI-D インターフェース		ライン入力
LAN 	LAN インターフェース。WAN や電話の接続には承認されていない		ライン出力
	シリアルポート		マイク入力
	USB ポート		汎用オーディオジャック
	USB 2.0 高速ポート		ヘッドフォン出力
	USB 3.0 超高速ポート		
	USB 3.1 SuperSpeedPlus インターフェース		

略語リスト

D.1 略語

略語	用語(フルスペル)	意味
AC	Alternating current	交流
AHCI	Advanced Host Controller Interface	SATA 装置用の標準化されたコントローラインターフェース。
APIC	Advanced Programmable Interrupt Controller	拡張プログラマブル割り込みコントローラ
AWG	American Wire Gauge	ケーブル径の米国規格
CAN	Controller Area Network	
CE	Communauté Européenne (CE マーク)	本製品は、適用されるすべての EC 指令に準拠しています。
CLK	Clock pulse	コントローラのクロック信号
CMOS	Complementary Metal Oxide Semiconductors	相補型金属酸化膜半導体
COA	Certificate of Authenticity	Microsoft Windows のプロダクトキー
COM	Communications Port	シリアルインターフェースの用語
CPU	Central Processing Unit	CPU
CRT	Cathode Ray Tube	
CSA	Canadian Standards Association	自国または二国間規格(UL/USA)の規格に準拠して試験および認証を行う、カナダの組織
DC	Direct Current	直流電流
DMA	Direct Memory Access	ダイレクトメモリアクセス

略語	用語(フルスペル)	意味
DPP / DP	DisplayPort	新しい強力なデジタルモニタポート
DQS	Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Qualitätsmanagement mBH	
DVI / DVI-D	Digital Visual Interface	VGA 信号なしのデジタル表示インターフェース
DVI-I	Digital Visual Interface	デジタル信号および VGA 信号による、デジタルディスプレイインターフェース
ECC	Error checking and correction	エラー修正コード
EFI	Extensible Firmware Interface	
ESD	Electrostatic-sensitive components	
EN	European standard	
GND	Ground	筐体接地
HDD	Hard Disk Drive	ハードディスクドライブ
HU	Height unit	
I/O	Input/Output	コンピュータ上のデータの入力/出力
iAMT	Intel® Active Management Technology	
IEC	International Electrotechnical Commission	
IP	Ingress Protection	保護等級
IRQ	Interrupt Request	割り込み要求
KVM	Keyboard Video Mouse	キーボードビデオマウスバイパス
LAN	Local Area Network	ローカルエリアに制限されたコンピュータネットワーク
LCD	Liquid Crystal Display	液晶ディスプレイ
LED	Light Emitting Diode	発光ダイオード
MUI	Multilanguage User Interface	Windows の多言語オペレーティングシステム、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語およびイタリア語の 5 言語の切り替えが可能
NEMA	National Electrical Manufacturers Association	米国電機製造業者協会

略語リスト

D.1 略語

略語	用語(フルスペル)	意味
NVRAM	Non Volatile Random Access Memory	不揮発性データメモリ。データメモリは外部電源がなくても保持されます。
OPC	OLE for Process Control	工業用プロセッサの標準インターフェース
PCI	Peripheral Component Interconnect	高速拡張バス
PCIe	Peripheral Component Interconnect Express	データ転送速度が速い、高速シリアル差動全二重 PtP インターフェース。
PIC	Programmable Interrupt Controller	プログラム可能な割り込みコントローラ
PXE	Preboot Execution Environment	ネットワークを介したハードディスクなしで新しい PC を実行するためのソフトウェア
RAID	Redundant Array of Independent Disks	冗長化ハードディスク配列
RAM	Random Access Memory	
SATA	Serial Advanced Technology Attachment	
SELV	Safety Extra Low Voltage	安全性特別低電圧
SMART	Self Monitoring Analysis and Reporting Technology	ハードディスクエラー診断プログラム
SNMP	Simple Network Management Protocol	ネットワークプロトコル
SSD	ソリッドステートドライブ	
TPM	Trusted Platform Module	
UEFI	Unified Extensible Firmware Interface	
UL	Underwriters Laboratories Inc.	自国または二国間規格(CSA/カナダ)の規格に準拠して試験および認証を行う、米国の組織。
USB	Universal Serial Bus	
VGA	Video Graphics Array	工業規格に適合するビデオアダプタ
WD	Watchdog	エラー検出とアラーム付きのプログラムモニタリング

索引

C

CE マーキング, 91
COA ラベル, 33

E

EAC, 94
Ethernet, 84
EU 適合性宣言, 91

F

FCC, 93

I

Image & Partition Creator, 75

P

Pile au lithium, 72
PROFIBUS, 52
PROFINET, 52

R

RJ45 Ethernet, 52

S

SIMATIC IPC Image & Partition Creator, (Image &
Partition Creator)
SIMATIC NET, 52
SIMATIC S7, 52

SOFTNET S7, 52

い

インターフェース, 84, 84
Ethernet RJ 45, 52
PROFINET, 52

お

オーストラリア, 94
オペレーティングシステム
初期コミッショニング, 54
オンライン注文システム, 52

か

カナダ, 94

く

グラフィックコントローラ, 83

け

ケーブルの固定, 53

し

システムリソース, 101

す

ストレインリリーフ, 53

せ

セットアップ, (BIOS Setup)

た

タッチスクリーン
操作, 57

て

データバックアップ, 75
データ交換, 52

と

ドライブ
SIMATIC IPC Slider で交換します, 67

に

ニュージーランド, 94

ふ

プロセッサ, 82

ま

マーキング
EU 適合性宣言, 91
マザーボード
設計, 97
マルチタッチ装置
取り付け, 40

め

メインメモリ, 82
メモリモジュール, 82
メモリモジュールの取り付け, 65

ら

ラベル付け, 94
韓国, 94

り

リチウム電池, 71

漢字

安全に関する注意事項
全般, 19
温度, 81
開く
装置, 60
機械的周囲条件, 81
気候条件, 81
梱包の中身, 32
確認, 32
識別データ, 33
取り付け
マルチタッチ装置, 40
モジュール, 63
取り付けカットアウト
準備, 37
寸法, 37
取り付けクリップ
マルチタッチ装置の設置, 40
承認, (EAC)
据え付け位置, 35
寸法, 86, 87, 88, 89
寸法図, 86, 87, 88, 89
拡張モジュール(M.2), 90

接続

- 保護導体, 45

設計

- マザーボード, 97

操作

- タッチスクリーン, 57

装置

- 開く, 60

- 電源オフ, 56

- 電源オン, 54

- 装置の寸法, 86, 87, 88, 89

- 適用範囲, 3

電源

- 接続, 49

- 電力消費, 76

- 電力要件, 78

- 等電位ボンディング, 45

- 認証, 91

- 認証と認可, 92

- 品質管理通知, 32

- 保護等級, 36, 77

- 保護導体, 29, 45

- 接続, 45

- 保護導体接続, 29

- 包装, 32

- 確認, 32

- 取り外し, 32

- 妨害電波放射, 80

- 略語, 114, 116